

Dell OptiPlex 5060 スモール フォーム ファクタ — サービスマニュアル



メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: コンピュータ内部の作業	5
安全にお使いいただくために.....	5
コンピュータの電源を切る — Windows 10.....	5
コンピュータ内部の作業を始める前に.....	6
コンピュータ内部の作業を終えた後に.....	6
章 2: テクノロジとコンポーネント	7
プロセッサ.....	7
DDR4.....	7
USB の機能.....	8
USB Type-C.....	10
HDMI 2.0.....	12
DisplayPort over USB Type-C の利点.....	13
章 3: コンポーネントの取り外しと取り付け	14
推奨ツール.....	14
ネジのサイズリスト.....	14
スモールフォームファクターのマザーボードのレイアウト.....	15
サイドカバー.....	16
サイドカバーの取り外し.....	16
サイドカバーの取り付け.....	16
拡張カード.....	17
拡張カードの取り外し.....	17
拡張カードの取り付け.....	18
コイン型電池.....	19
コイン型電池の取り外し.....	19
コイン型電池の取り付け.....	20
ハードドライブアセンブリ.....	21
ハードドライブアセンブリの取り外し.....	21
ハードドライブアセンブリの取り付け.....	22
ベゼル.....	23
前面ベゼルの取り外し.....	23
前面ベゼルの取り付け.....	24
オプティカルドライブ.....	25
オプティカルドライブの取り外し.....	25
オプティカルドライブの取り付け.....	29
ハードドライブとオプティカルドライブモジュール.....	32
ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り外し.....	32
ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り付け.....	35
メモリモジュール.....	38
メモリモジュールの取り外し.....	38
メモリモジュールの取り付け.....	39
ヒートシンク ファン.....	40
ヒートシンク ファンの取り外し.....	40

ヒートシンク ファンの取り付け.....	41
ヒートシンクアセンブリ.....	42
ヒートシンク アセンブリーの取り外し.....	42
ヒートシンク アセンブリーの取り付け.....	43
インテルージョンスイッチ.....	44
インテルージョン スwitchの取り外し.....	44
インテルージョンスイッチの取り付け.....	45
電源スイッチ.....	46
電源スイッチの取り外し.....	46
電源スイッチの取り付け.....	47
プロセッサ.....	48
プロセッサの取り外し.....	48
プロセッサの取り付け.....	49
M.2 PCIe SSD.....	50
M.2 PCIe SSD の取り外し.....	50
M.2 PCIe SSD の取り付け.....	51
電源装置ユニット.....	52
PSU (電源供給ユニット) の取り外し.....	52
PSU (電源装置ユニット) の取り付け.....	54
スピーカー.....	56
スピーカーの取り外し.....	56
スピーカーの取り付け.....	57
システム基板.....	58
システム基板の取り外し.....	58
システム基板の取り付け.....	62
章 4: トラブルシューティング.....	66
強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断.....	66
ePSA 診断の実行.....	66
電源供給ユニットのビルトイン自己テスト.....	67
診断.....	67
診断エラーメッセージ.....	68
システムエラーメッセージ.....	72
オペレーティング システムのリカバリ.....	72
リアルタイム クロック (RTC リセット)	73
バックアップ メディアとリカバリー オプション.....	73
Wi-Fi 電源の入れ直し.....	73
章 5: ヘルプ.....	74
デルへのお問い合わせ.....	74

コンピュータ内部の作業

トピック：

- 安全にお使いいただくために
- コンピュータの電源を切る — Windows 10
- コンピュータ内部の作業を始める前に
- コンピュータ内部の作業を終えた後に

安全にお使いいただくために

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピュータに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。

① メモ: コンピュータのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業が終わったら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けてから、電源に接続します。

⚠ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。その他、安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、[法令遵守のホームページ](#)を参照してください。

⚠ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

⚠ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、コンピュータの裏面にあるコネクタに触れる際に塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。



⚠ 注意: コンポーネントとカードは丁寧に取り扱いください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。

⚠ 注意: ケーブルを外すときは、コネクタまたはプルタブを引っ張り、ケーブル自身を引っ張らないでください。コネクタにロックタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロックタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

① メモ: お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピュータの電源を切る — Windows 10

⚠ 注意: データの消失を防ぐため、コンピュータの電源を切る、またはサイドカバーを取り外す前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。

1.  をクリックまたはタップします。
2.  をクリックまたはタップしてから、[[Shut down]] をクリックまたはタップします。

- ① メモ:** コンピュータとすべての周辺機器の電源が切れていることを確認します。オペレーティング システムをシャットダウンした際に、コンピューターおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを約 6 秒間長押しして電源を切ってください。

コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

1. 「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
2. コンピュータのカバーに傷つかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
3. コンピュータの電源を切ります。
4. コンピュータからすべてのネットワークケーブルを外します。

△ 注意: ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

5. コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
6. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。

① メモ: 静電気放出による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの裏面にあるコネクタに触れながら塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

コンピュータ内部の作業を終えた後に

取り付け手順が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルが接続されていることを確認してください。

1. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。

2. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
3. コンピュータの電源を入れます。
4. 必要に応じて [ePSA 診断] を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します。

テクノロジーとコンポーネント

この章には、システムで使用可能なテクノロジーとコンポーネントの詳細が掲載されています。

トピック：

- プロセッサ
- DDR4
- USB の機能
- USB Type-C
- HDMI 2.0
- DisplayPort over USB Type-C の利点

プロセッサ

OptiPlex 5060 システムには、インテル第 8 世代 Coffee Lake チップセットとコア プロセッサ テクノロジーが搭載されています。

①メモ: クロック速度とパフォーマンスは、作業負荷およびその他の変数に応じて異なります。キャッシュ合計はプロセッサのタイプによって異なりますが、最大 8 MB です。

- インテル Pentium Gold G5400 (2 コア/4 MB/4 T/3.1 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート
- インテル Pentium Gold G5500 (2 コア/4 MB/4 T/3.2 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート
- インテル Core i3-8100 (4 コア/6 MB/4 T/3.1 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート
- インテル Core i3-8300 (4 コア/8 MB/4 T/3.2 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート
- インテル Core i5-8400 (6 コア/9 MB/6 T/最大 3.3 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート
- インテル Core i5-8500 (6 コア/9 MB/6 T/最大 3.5 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート
- インテル Core i5-8600 (6 コア/9 MB/6 T/最大 3.7 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート
- インテル Core i7-8700 (6 コア/12 MB/12 T/最大 4.0 GHz/35 W)、Windows 10/Linux をサポート

DDR4

DDR4 (Double Data Rate 第 4 世代) メモリは、DDR2 および DDR3 の後継にあたる高速テクノロジーであり、DDR3 の最大 128 GB (DIMM あたり) と比べて、容量が最大 512 GB へと拡大しています。DDR4 同期ダイナミックランダムアクセスメモリは、切り込みの位置が SDRAM および DDR と異なっていて、誤った種類のメモリがシステムに取り付けられるのを防いでいます。

DDR3 の動作には 1.5 ボルトの電力が必要であるのに対し、DDR4 は 1.2 ボルトと 20 パーセントの省電力となっています。また、DDR4 には、ホストデバイスがメモリをリフレッシュすることなくスタンバイモードに入れる新たなディープパワーダウンモードが装備されています。ディープパワーダウンモードは、スタンバイ時の電力消費を 40 ~ 50 パーセント削減すると見込まれています。

DDR4 の詳細

DDR3 メモリモジュールと DDR4 メモリモジュールには、以下のような微妙な違いがあります。

キーノッチ (切り込み) の違い

DDR4 モジュールの切り込みは、DDR3 モジュールの切り込みとは異なる位置にあります。どちらの切り込みも挿入側にありますが、DDR4 の切り込みの位置は少し異なっていて、互換性のない基板やプラットフォームにモジュールを装着できないようになっています。

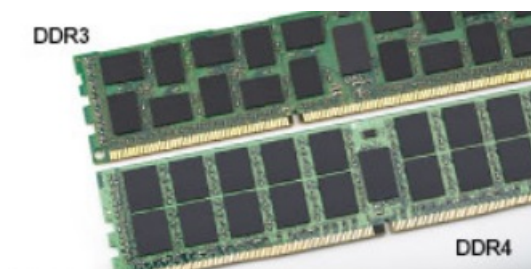


図 1. 切り込みの違い

厚さの増加

DDR4 モジュールは、より多くの信号レイヤを収容するために DDR3 よりもわずかに厚さが増えています。

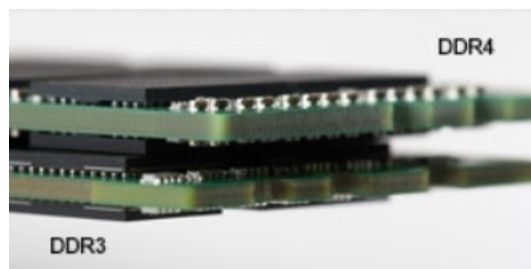


図 2. 厚さの違い

カーブしたエッジ

DDR4 モジュールの特徴としてエッジがカーブしていて、差し込みが容易になると共に、メモリ取り付け時の PCB へのストレスが緩和されます。

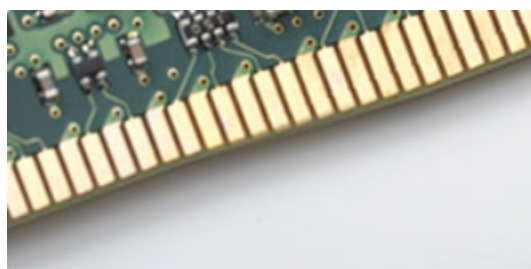


図 3. カーブしたエッジ

メモリエラー

システムでのメモリエラーは、「点灯 - 点滅 - 点滅」または「点灯 - 点滅 - 点灯」という新しい障害コードで表示されます。すべてのメモリが障害となると、LCD は点灯しません。メモリ障害の可能性をトラブルシューティングするには、正常であることがわかっているメモリモジュールをシステム底面（一部のポータブルシステムではキーボードの下）にあるメモリコネクタに取り付けます。

USB の機能

USB（ユニバーサルシリアルバス）は 1996 年に導入されました。これにより、ホストコンピューターと周辺機器（マウス、キーボード、外付けドライバー、プリンターなど）との接続が大幅にシンプルになりました。

下記の表を参照して USB の進化について簡単に振り返ります。

表 1. USB の進化

タイプ	データ転送速度	カテゴリ	導入された年
USB 2.0	480 Mbps	High Speed	2000

表 1. USB の進化 (続き)

タイプ	データ転送速度	カテゴリ	導入された年
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Super Speed	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Super Speed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

長年にわたり、USB 2.0 は、PC 業界の事実上のインターフェイス標準として確実に定着しており、約 60 億個のデバイスがすでに販売されていますが、コンピューティングハードウェアのさらなる高速化と広帯域幅化へのニーズの高まりから、より高速なインターフェイス標準が必要になっています。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、理論的には USB 2.0 の 10 倍のスピードを提供することで、このニーズに対する答えをついに実現しました。USB 3.1 Gen 1 の機能概要を次に示します。

- より速い転送速度 (最大 5 Gbps)
- 電力を大量消費するデバイスにより良く適応させるために拡大された最大バスパワーとデバイスの電流引き込み
- 新しい電源管理機能
- 全二重データ転送と新しい転送タイプのサポート
- USB 2.0 の下位互換性
- 新しいコネクタとケーブル

以下のトピックには USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 に関するよくある質問の一部が記載されています。

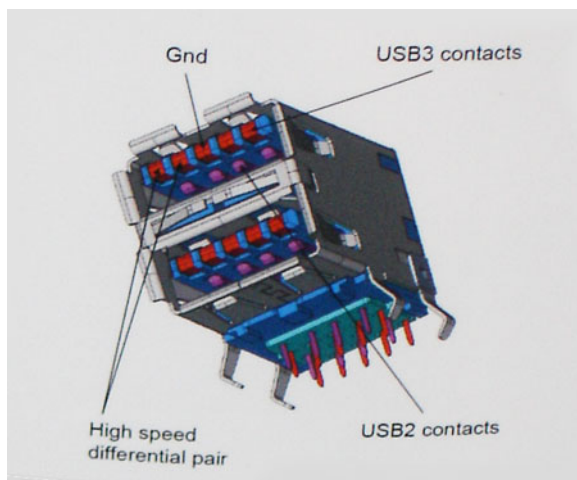


スピード

現時点で最新の USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 仕様では、Super-Speed、Hi-Speed、および Full-Speed の 3 つの速度モードが定義されています。新しい SuperSpeed モードの転送速度は 4.8 Gbps です。この仕様では下位互換性を維持するために、Hi-speed モード (USB 2.0、480 Mbps) および Full-speed モード (USB 1.1、12 Mbps) の低速モードもサポートされています。

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は次の技術変更によって、パフォーマンスをさらに向上させています。

- 既存の USB 2.0 バスと並行して追加された追加の物理バス (以下の図を参照)。
- USB 2.0 には 4 本のワイヤ (電源、接地、および差分データ用の 1 組) がありましたが、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では 2 組の差分信号 (送受信) 用にさらに 4 本追加され、コネクタとケーブルの接続は合計で 8 個になります。
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、USB 2.0 の半二重配置ではなく、双方向データ インターフェイスを使用します。これにより、帯域幅が理論的に 10 倍に増加します。



高精細ビデオコンテンツ、テラバイトのストレージデバイス、超高解像度のデジタルカメラなどのデータ転送に対する要求がますます高まっている現在、USB 2.0 は十分に高速ではない可能性があります。さらに、理論上の最大スループットである 480 Mbps を達成する USB 2.0 接続は存在せず、現実的なデータ転送率は、最大で約 320 Mbps (40 MB/s) となっています。同様に、USB

3.0/USB 3.1 Gen 1 接続が 4.8 Gbps のスループットを達成することはありません。実際には、オーバーヘッドを含めて 400 MB/s の最大転送率であると想定されますが、このスピードでも、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は USB 2.0 の 10 倍向上しています。

用途

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 により、デバイスで転送率が向上し、帯域幅に余裕ができるので、全体的なエクスペリエンスが向上します。以前の USB ビデオは、最大解像度、レイテンシー、およびビデオ圧縮のそれぞれの観点でほとんど使用に耐えないものでしたが、利用可能な帯域幅が 5~10 倍になれば、USB ビデオソリューションの有用性ははるかに向上することが容易に想像できます。単一リンクの DVI では、約 2 Gbps のスループットが必要です。480 Mbps では制限がありましたが、5 Gbps では十分すぎるほどの帯域幅が実現します。4.8Gbps のスピードが見込めることで、新しいインターフェイス標準の利用範囲は、以前は USB 領域ではなかった外部 RAID ストレージシステムのような製品へと拡大する可能性があります。

以下に、使用可能な SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 の製品の一部をリストアップします。

- デスクトップ用外付け USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハードドライブ
- ポータブル USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハードドライブ
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ドライブ ドックおよびアダプター
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 フラッシュ ドライブおよびリーダー
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ソリッドステート ドライブ
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
- オプティカルメディアドライブ
- マルチメディアドライブ
- ネットワーキング
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 アダプター カードおよびハブ

互換性

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は最初から慎重に計画されており、USB 2.0 との互換性を完全に維持しています。まず、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では新しいプロトコルの高速能力を利用するために、新しい物理接続と新しいケーブルが指定されていますが、コネクタ自体は、4 か所の USB 2.0 接点が以前と同じ場所にある同じ長方形のままです。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ケーブルには独立してデータを送受信するための 5 つの新しい接続があり、これらは、適切な SuperSpeed USB 接続に接続されている場合にのみ接続されます。

Windows 8/10 は USB 3.1 Gen 1 コントローラーを標準装備しています。一方、以前のバージョンの Windows では、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 コントローラー用の個別のドライバが引き続き必要です。

Microsoft は、Windows 7 での USB 3.1 Gen 1 サポートを発表しましたが、直近のリリースではなく、後続の Service Pack または更新プログラムでサポートされると予想されます。Windows 7 で USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 サポートのリリースが成功した後、SuperSpeed のサポートが Vista で実現する可能性もあります。Vista でも USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 をサポートすべきであるという意見をパートナーの大半が持っているとして Microsoft も述べており、こうした可能性を裏付けています。

USB Type-C

USB Type C は新しい小型物理コネクタです。コネクタ自身で USB 3.1 や USB Power Delivery (USB PD) などのさまざまな新しい USB 規格をサポートできます。

代替モード

USB Type-C はとても小さな新しいコネクタ規格で、古い USB Type-A プラグのおよそ 3 分の 1 のサイズです。これは単一コネクタ規格のため、すべてのデバイスで使用できます。USB Type-C ポートは、「代替モード」を使用して多種多様なプロトコルをサポートできます。このモードによって、アダプタは HDMI、VGA、DisplayPort などの接続タイプからの信号を 1 つの USB ポートから出力できるようになります。

USB Power Delivery

USB PD 仕様もまた USB Type-C と密接に関わっています。現在、スマートフォン、タブレット、およびその他のモバイルデバイスの充電には、多くの場合、USB 接続が使用されています。USB 2.0 接続は最大で 2.5 W の電力を供給するため、携帯電話の充電には使用できますが、それが限度です。たとえば、ラップトップでは最大で 60 W の電力が必要な場合があります。USB Power

Delivery 仕様ではこの電力供給を 100 W にまで引き上げます。双方向性があるため、デバイスは電力を送受信できます。また、電力を送受信すると同時に、接続を通してデータを転送することができます。

これにより標準の USB 接続からすべての機器を充電できるようになるため、ラップトップ専用の充電ケーブルに終わりを告げるようになります。今日からは、スマートフォンやその他のポータブルデバイスを充電するポータブルバッテリーパックからラップトップを充電することができます。電源ケーブルに接続した外付けディスプレイにラップトップを差し込むと、この外付けディスプレイはラップトップを充電します。もちろん、外付けディスプレイは以前と同じように使用できます。これが 1 つの小さな USB Type-C 接続で実現します。これを使用するには、デバイスとケーブルが USB Power Delivery をサポートしている必要があります。USB Type-C 接続があるだけでは必ずしもサポートしているとは限りません。

USB Type-C および USB 3.1

USB 3.1 は、新しい USB 規格です。USB 3 では理論上の帯域幅が 5 Gbps であるのに比べ、USB 3.1 では 10 Gbps になります。これは 2 倍の帯域幅で、第 1 世代 Thunderbolt コネクタと同じ速度です。USB Type-C は USB 3.1 とは異なります。USB Type-C はコネクタの形状をしており、基盤となるテクノロジーは USB 2 または USB 3.0 です。Nokia の N1 Android タブレットでは USB Type-C コネクタを使用していますが、実際に使用されているのはすべて USB 2.0 です。USB 3.0 でもありません。しかし、これらのテクノロジーは密接に関わっています。

Thunderbolt over Type-C

Thunderbolt は、データ、ビデオ、オーディオ、電源を 1 つの接続にまとめることができるハードウェアインターフェースです。Thunderbolt では、PCI Express (PCIe) と DisplayPort (DP) を 1 つのシリアル信号に結合し、DC 電源も含め、すべてを 1 本のケーブルで提供できます。Thunderbolt 1 と Thunderbolt 2 は miniDP (DisplayPort) と同じコネクタを使用して周辺機器と接続します。これに対し、Thunderbolt 3 は USB Type-C コネクタを使用します。

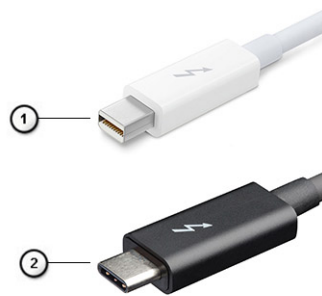


図 4. Thunderbolt 1 と Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 と Thunderbolt 2 (miniDP コネクタを使用)
2. Thunderbolt 3 (USB Type-C コネクタを使用)

Thunderbolt 3 over Type-C


Thunderbolt 3 では、最大 40 Gbps の速度で USB Type-C に接続できます。すべての機能をコンパクトな 1 つのポートに集約しており、どのようなドック、ディスプレイ、外付けハードドライブなどのデータデバイスに対しても、高速な接続と優れた汎用性を実現します。Thunderbolt 3 は USB Type-C コネクタ / ポートを使用して、サポートしている周辺機器に接続します。

1. Thunderbolt 3 は、コンパクトでリバーシブルな USB Type-C コネクタとケーブルを使用
2. Thunderbolt 3 は、最大 40 Gbps の速度に対応
3. DisplayPort 1.2 – 既存の DisplayPort モニター、デバイス、ケーブルとの互換性あり
4. USB Power Delivery - サポートしているコンピュータ上で最大 130 W の電力供給

Thunderbolt 3 over USB Type-C の主な特徴

1. Thunderbolt、USB、DisplayPort、USB Type-C での給電を、1 本のケーブルで対応 (製品によって機能は異なります)
2. コンパクトでリバーシブルな USB Type-C コネクタとケーブル
3. Thunderbolt ネットワークをサポート (*製品によって異なります)
4. 最大 4K ディスプレイをサポート

5. 最大 40 Gbps

 **メモ:** データ転送速度は、デバイスに応じて異なる場合があります。

Thunderbolt アイコン



Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable		Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable		Up to 130 Watts via USB Type-C

図 5. Thunderbolt アイコンのバリエーション

HDMI 2.0

このトピックでは、HDMI 2.0 とその機能について利点と合わせて説明します。

HDMI (高精細度マルチメディアインタフェース) は、業界から支持される、非圧縮、全デジタルオーディオ/ビデオインタフェースです。HDMI は、DVD プレーヤーや A/V レシーバーなどの互換性のあるデジタルオーディオ/ビデオソースと、デジタル TV (DTV) などの互換性のあるデジタルオーディオ/ビデオモニター間のインタフェースを提供します。HDMI の対象とされる用途はテレビおよび DVD プレーヤーです。主な利点は、ケーブルの削減とコンテンツ保護プロビジョニングです。HDMI は、標準、拡張、または高解像度ビデオと、単一ケーブル上のマルチチャンネルデジタルオーディオをサポートします。

HDMI 2.0 の機能

- **HDMI イーサネットチャンネル** - 高速ネットワークを HDMI リンクに追加すると、ユーザーは別のイーサネットケーブルなしで IP 対応デバイスをフル活用できます。
- **オーディオリターンチャンネル** - チューナー内蔵の HDMI 接続 TV で、別のオーディオケーブルの必要なくオーディオデータ「アップストリーム」をサラウンドオーディオシステムに送信できます。
- **3D** - メジャーな 3D ビデオ形式の入力/出力プロトコルを定義し、本当の 3D ゲームと 3D ホームシアターアプリケーションの下準備をします。
- **コンテンツタイプ** - ディスプレイとソースデバイス間のコンテンツタイプのリアルタイム信号伝達によって、TV でコンテンツタイプに基づく画像設定を最適化できます。
- **追加のカラースペース** - デジタル写真やコンピュータグラフィックスで使用される追加のカラーモデルに対するサポートを追加します。
- **4K サポート** - 1080p をはるかに超えるビデオ解像度を可能にし、多くの映画館で使用されるデジタルシネマシステムに匹敵する次世代ディスプレイをサポートします。
- **HDMI マイクロコネクタ** - 1080p までのビデオ解像度をサポートする、電話やその他のポータブルデバイス用の新しく小さいコネクタです。
- **車両用接続システム** - 真の HD 品質を配信しつつ、自動車環境に特有の需要を満たすように設計された、車両用ビデオシステムの新しいケーブルとコネクタです。

HDMI の利点

- 高品質の HDMI で、鮮明で最高画質の非圧縮のデジタルオーディオとビデオを転送します。
- 低コストの HDMI は、簡単で効率の良い方法で非圧縮ビデオ形式をサポートすると同時に、デジタルインタフェースの品質と機能を提供します。
- オーディオ HDMI は、標準ステレオからマルチチャンネルサラウンドサウンドまで複数のオーディオ形式をサポートします。
- HDMI は、ビデオとマルチチャンネルオーディオを 1 本のケーブルにまとめることで、A/V システムで現在使用している複数のケーブルの費用、複雑さ、混乱を取り除きます。
- HDMI はビデオソース (DVD プレーヤーなど) と DTV 間の通信をサポートし、新しい機能に対応します。

DisplayPort over USB Type-C の利点

- フル DisplayPort A/V (オーディオ/ビデオ) パフォーマンス (60 Hz で最大 4K)
- リバーシブル プラグの向きとケーブルの向き
- VGA、アダプタ付 DVI との下位互換性
- SuperSpeed USB (USB 3.1) データ
- HDMI 2.0a をサポートし、前のバージョンと下位互換性があります

コンポーネントの取り外しと取り付け


トピック：

- 推奨ツール
- ネジのサイズリスト
- スモールフォームファクターのマザーボードのレイアウト
- サイドカバー
- 拡張カード
- コイン型電池
- ハードドライブアセンブリ
- ベゼル
- オプティカルドライブ
- ハードドライブとオプティカルドライブモジュール
- メモリモジュール
- ヒートシンク ファン
- ヒートシンクアセンブリ
- イントルージョンスイッチ
- 電源スイッチ
- プロセッサ
- M.2 PCIe SSD
- 電源装置ユニット
- スピーカー
- システム基板

推奨ツール

本マニュアルの手順には以下のツールが必要です。

- #0 プラスドライバ
- #1 プラスドライバ
- プラスチックスクライバ

 **メモ:** #0 ドライバはネジ 0 ~ 1 に使用し、#1 ドライバはネジ 2 ~ 4 に使用します。

ネジのサイズリスト

表 2. ネジのサイズリスト





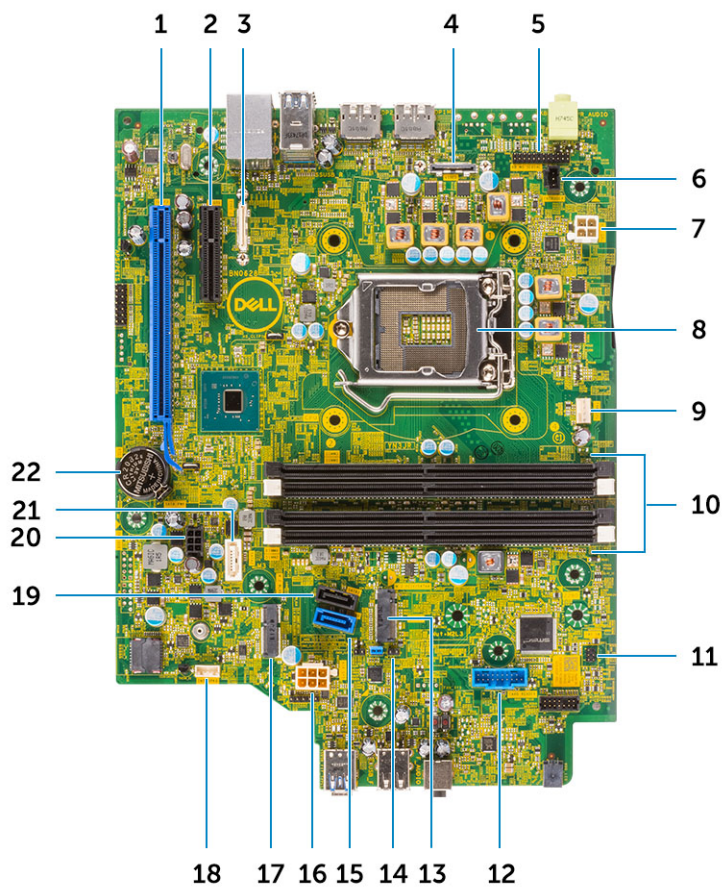
コンポーネント	M2x3.5 	M3X3 	M3X5 	6-32X1/4" 
WLAN	1			
SSD カード	1			
電源装置ユニット (PSU)				3
IO モジュール		2		
内蔵アンテナ		2		

表 2. ネジのサイズリスト (続き)

コンポーネント	M2x3.5	M3X3	M3X5	6-32X1/4"
カードリーダー			2	
システム基板				5
前面 IO ブラケット				1

スモールフォームファクターのマザーボードのレイアウト



スモールフォームファクターの基板のコンポーネント

1. PCI-e x16 コネクタ (スロット 1)
2. PCI-e x4 コネクタ (スロット 2)
3. オプションの Type C コネクタ
4. オプションのビデオコネクタ (HDMI 2.0b/DP/VGA)
5. キーボードおよびマウスのシリアルポートコネクタ (オプション)
6. インターダースイッチコネクタ
7. CPU 電源コネクタ (ATX_CPU)
8. CPU ソケットコネクタ
9. CPU ファンコネクタ
10. メモリスロット
11. 電源スイッチコネクタ

12. メディアカードリーダーコネクタ
13. M.2 SSD スロット
14. CMOS/パスワード/サービス モード ジャンパのクリア
15. SATA 0 コネクタ (青色)
16. システム電源コネクタ (ATX_SYS)
17. M.2 WLAN コネクタ
18. 内蔵スピーカーコネクタ
19. SATA 3 コネクタ (黒色)
20. SATA 電源ケーブルコネクタ
21. SATA 2 コネクタ (白色)
22. コイン型電池

サイドカバー

サイドカバーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. システムの背面にあるリリース ラッチをカチッと音がするまでスライドさせて、サイドカバーのロックを解除します [1]。
 - b. サイドカバーをスライドさせてシステムから持ち上げます [2]。



サイドカバーの取り付け

1. システムにカバーをセットし、カチッと所定の位置に収まるまでスライドさせます [1]。
2. リリース ラッチはサイドカバーをシステムに自動的にロックします [2]。

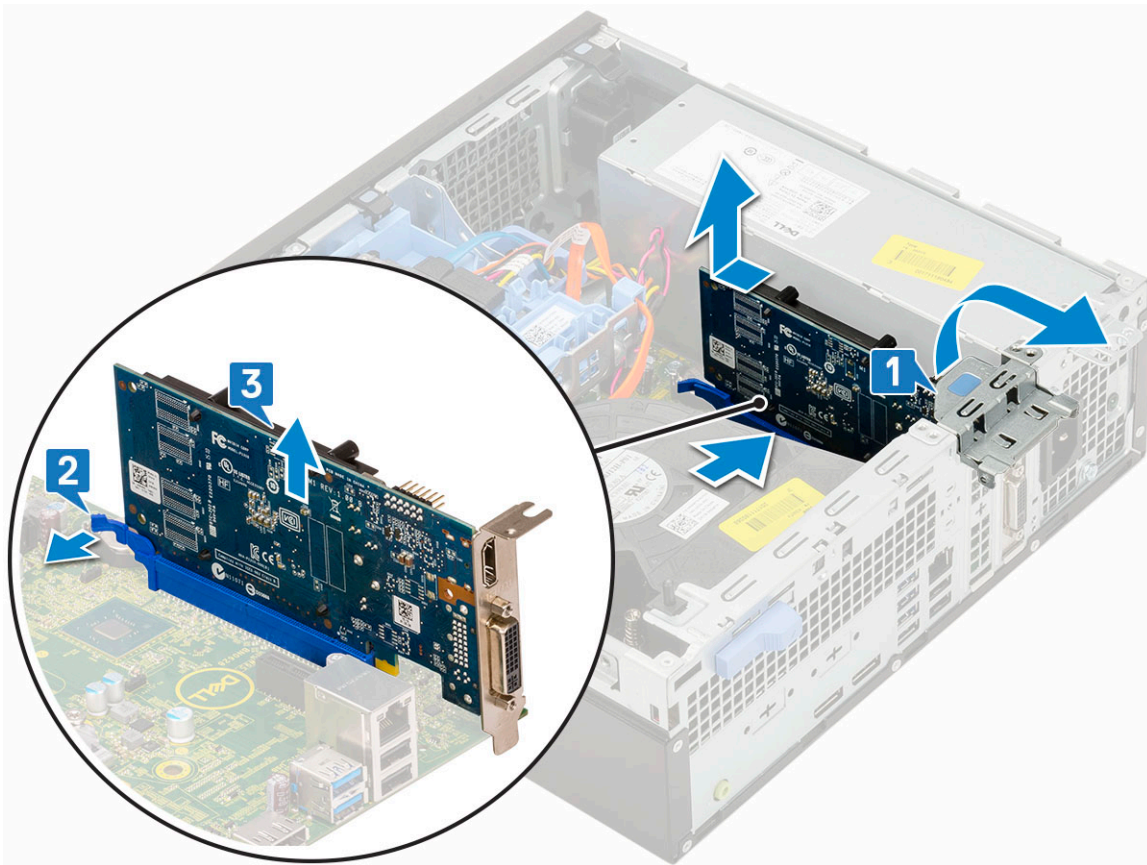


3. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

拡張カード

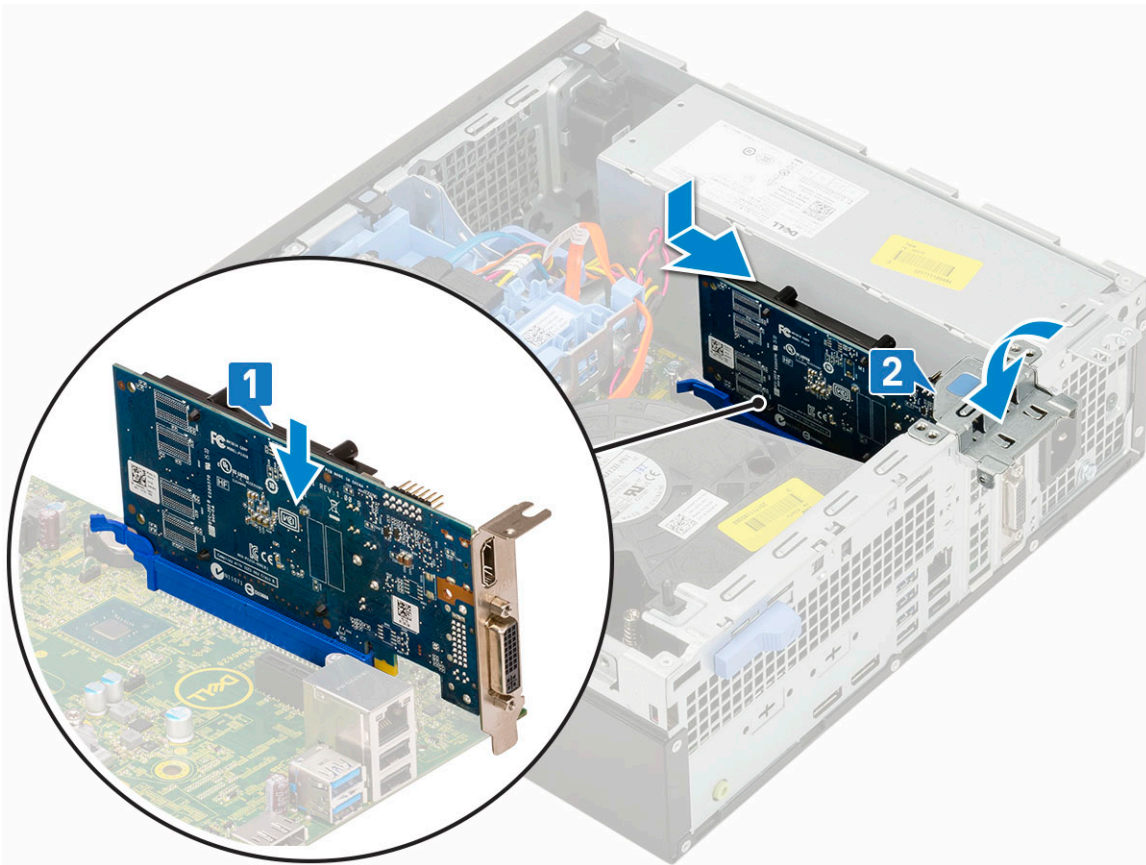
拡張カードの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. 拡張カードを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. 金属製のタブを引いて拡張カードラッチを開きます [1]。
 - b. 拡張カード底部のリリースタブを引きます [2]。
 - ① **メモ:** x16 カード スロットに適用され、x1 カードにはリリースタブがありません。
 - c. 拡張カードをシステム基板のコネクタから持ち上げて外します [3]。



拡張カードの取り付け

1. 拡張カードをシステム基板のコネクタに挿入します [1]。
2. 拡張カードが所定の位置にカチッと収まるまで押します [2]。
3. 拡張カード ラッチを閉じて、所定の位置にカチッと収まるまで押し込みます [3]。



4. サイドカバーを取り付けます。
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

コイン型電池

コイン型電池の取り外し

△注意: コイン型電池を取り外すと、マザーボードがリセットされることがあります。

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 拡張カード
3. コイン型電池を取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. プラスチック スクライブを使用して、コイン型電池が外れるまで、リリース ラッチを押します [1]。
 - b. コイン型電池をシステムから取り外します [2]。



コイン型電池の取り付け

1. 「+」記号を上に向けて、コイン型電池をシステム基板のロットにセットします [1]。
2. 所定の位置にロックされるまでバッテリーをコネクタに押し込みます [2、3]。

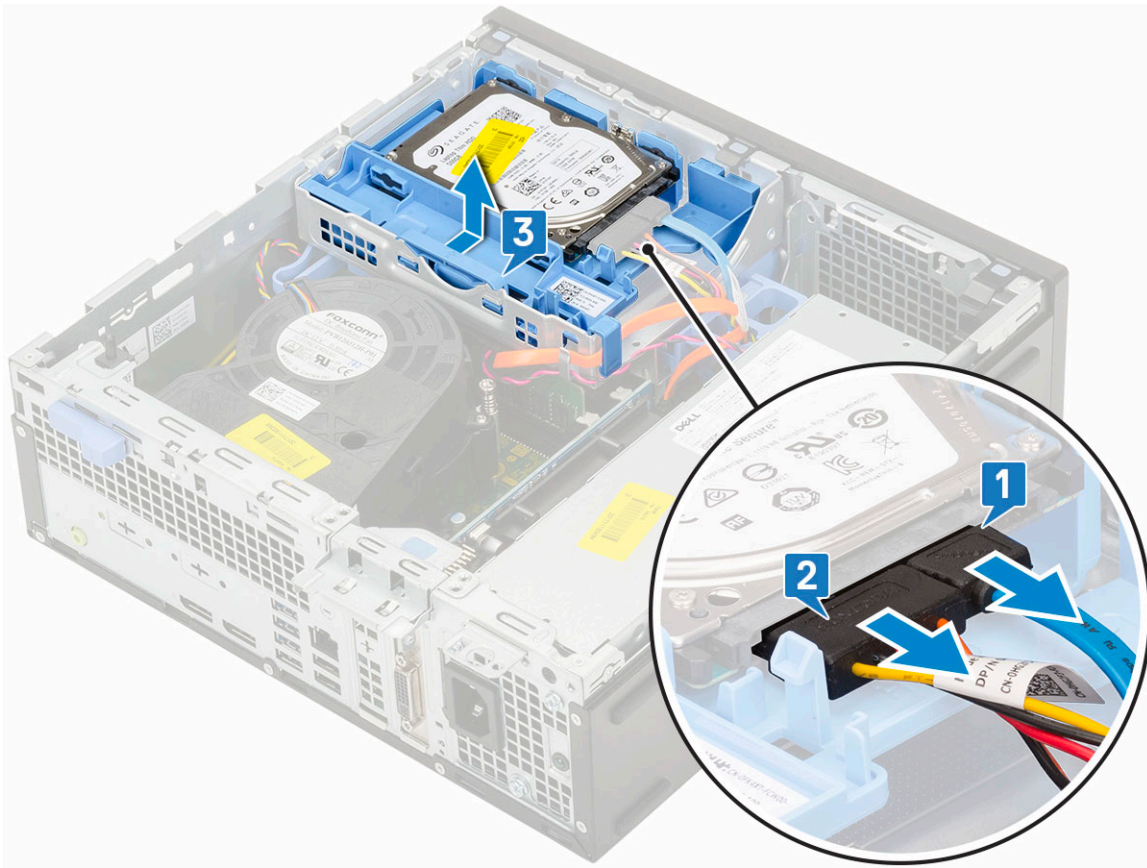


3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. 拡張カード
 - b. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ハードドライブアセンブリ

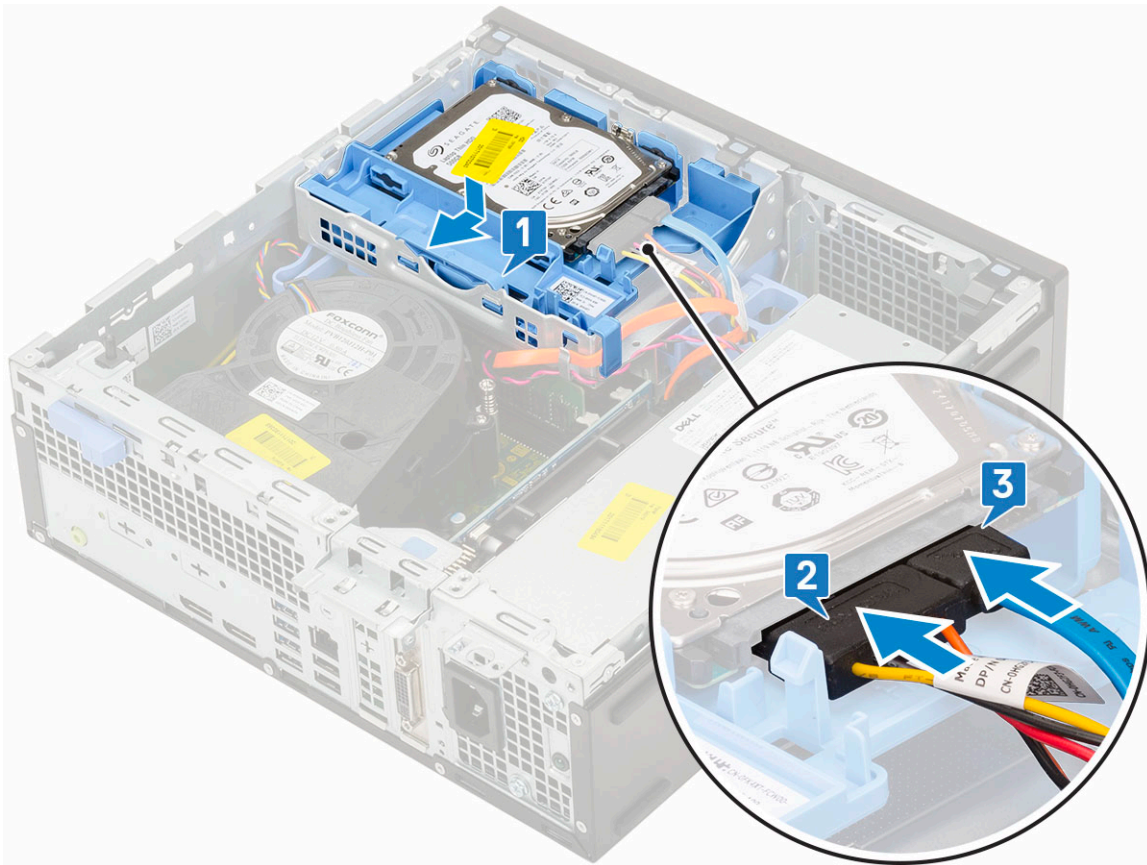
ハードドライブアセンブリの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. ハードドライブの取り外しは、次の手順で行います。
 - a. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタから外します [1, 2]。
 - b. リリースタブを押し、システムからハードドライブアセンブリを持ち上げます [3]。



ハードドライブアセンブリの取り付け

1. ハードドライブアセンブリをシステムのスロットに挿入します [1]。
2. 電源ケーブルとハードドライブケーブルをハードドライブのコネクタに接続します [2、3]。



3. サイドカバーを取り付けます。
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ベゼル

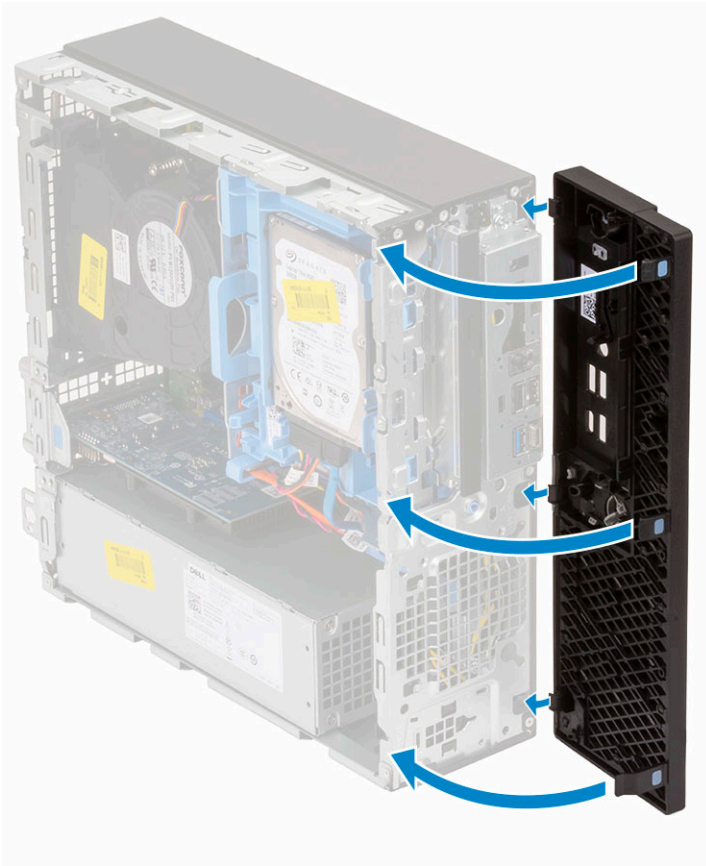
前面ベゼルの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. サイドカバーを取り外します。
3. 前面ベゼルを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. 固定タブを持ち上げて前面ベゼルをシステムから外します。
 - b. 前面ベゼルをシステムから取り外します。



前面ベゼルの取り付け

1. ベゼルをセットし、ベゼルの固定タブをシステムのスロットに差し込みます。
2. タブがカチッと所定の位置に収まるまで、ベゼルを押し込みます。

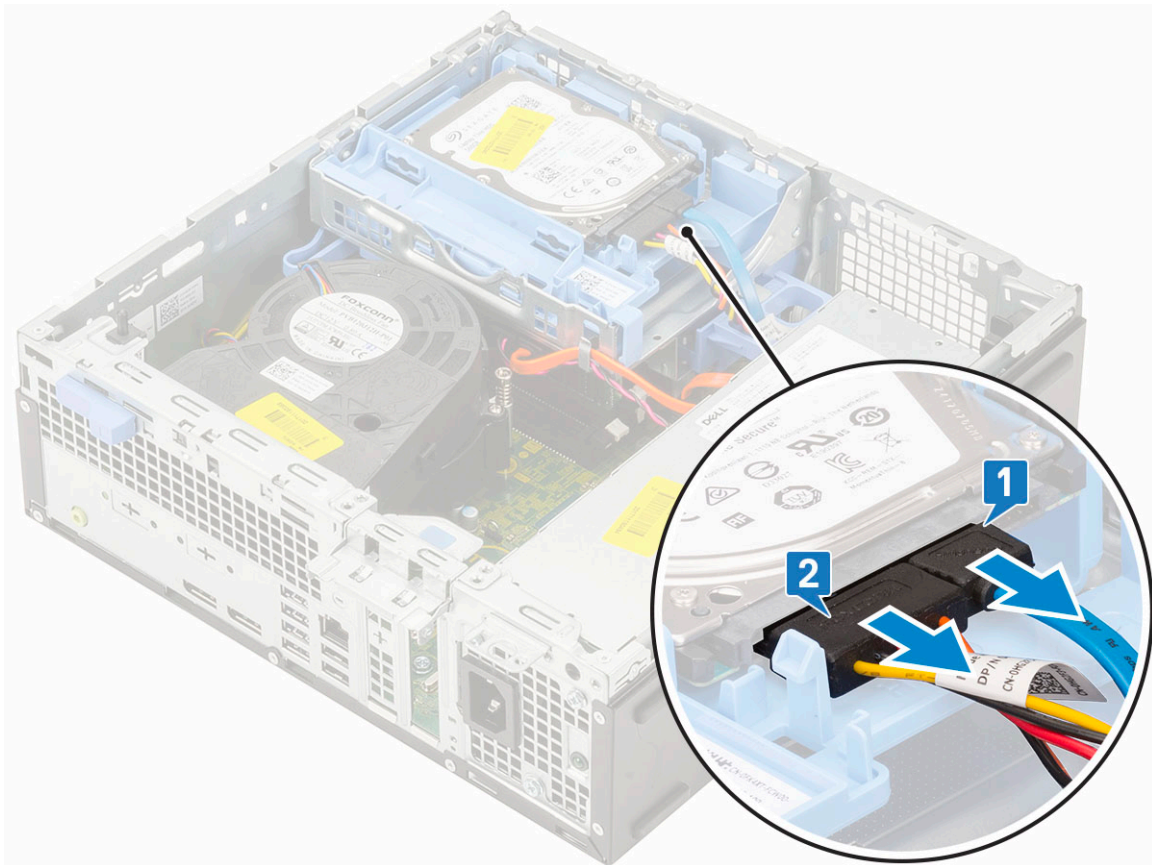


3. サイドカバーを取り付けます。
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

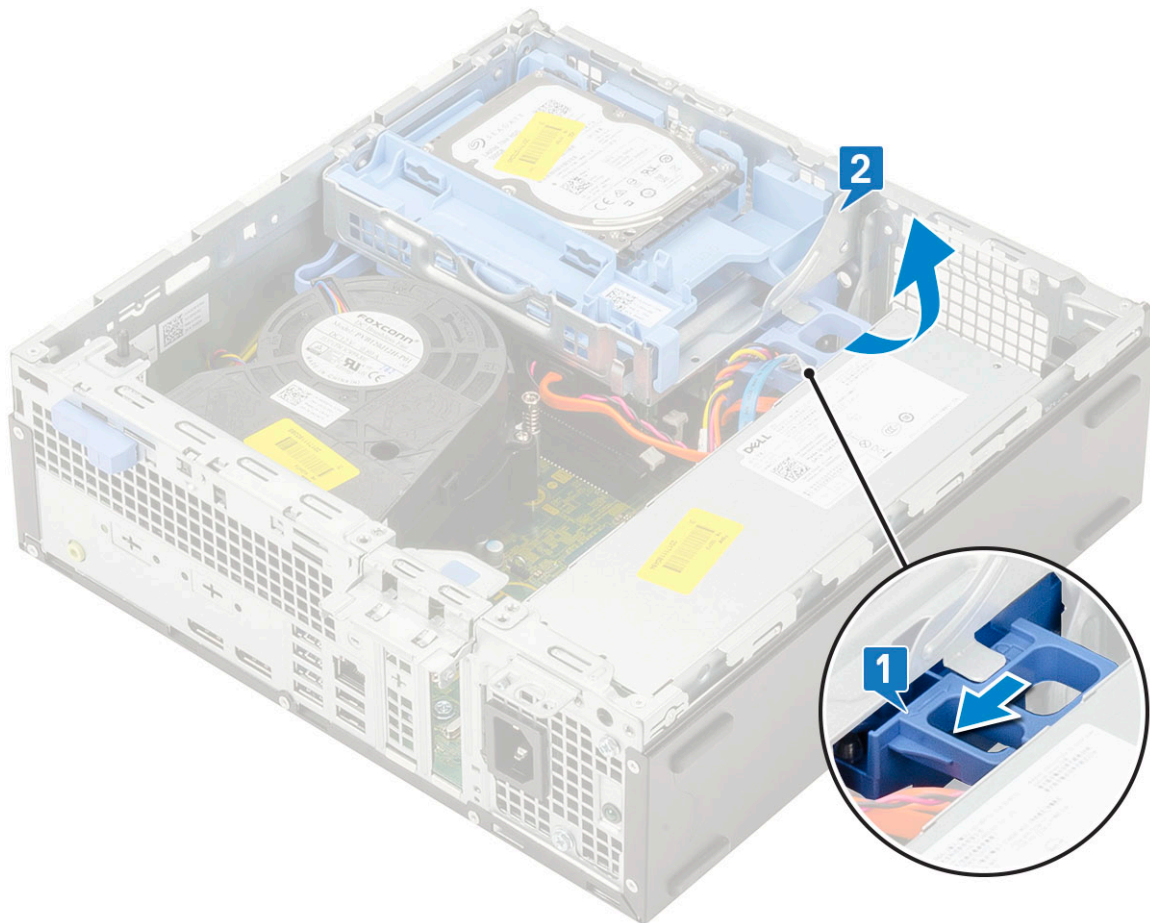
オプティカルドライブ

オプティカルドライブの取り外し

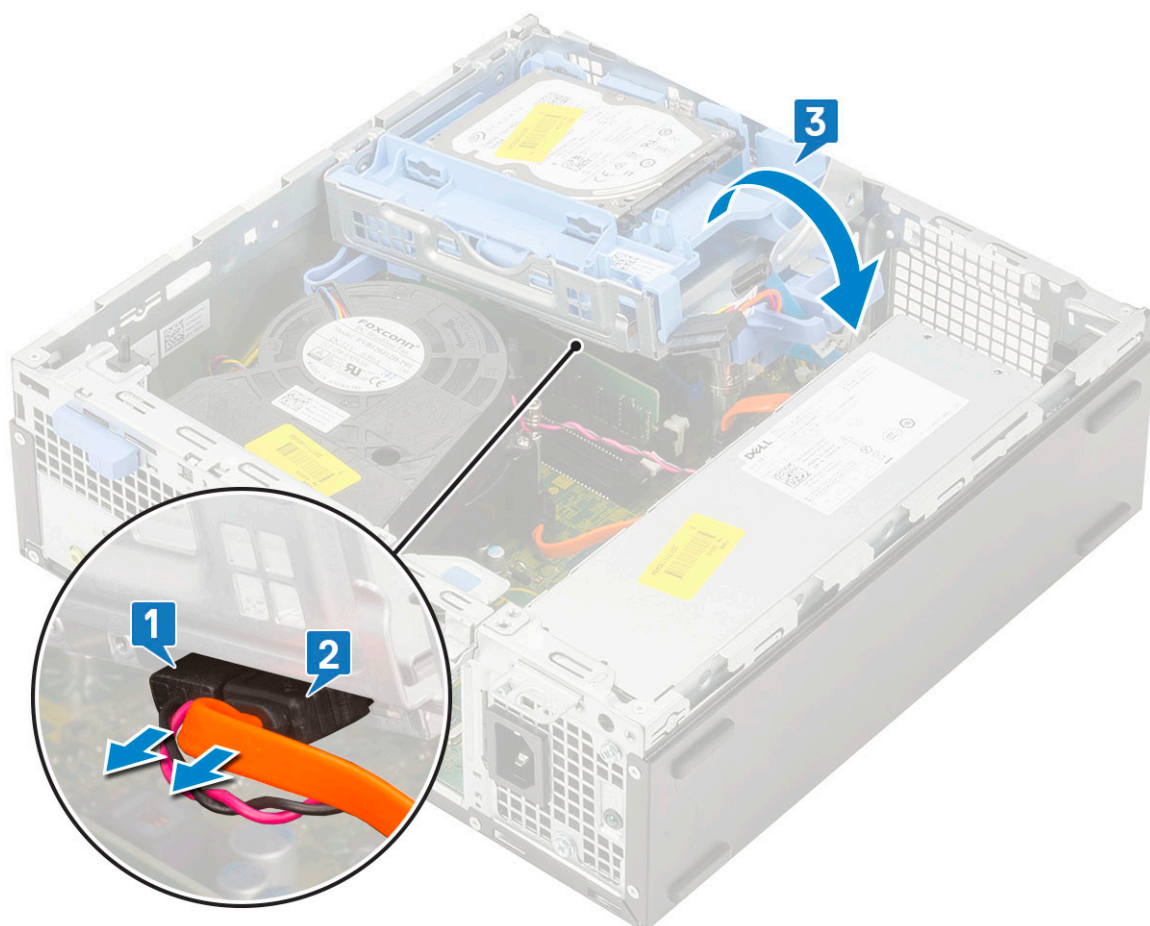
1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
3. オプティカルドライブを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルをハードドライブのコネクタから外します [1, 2]。



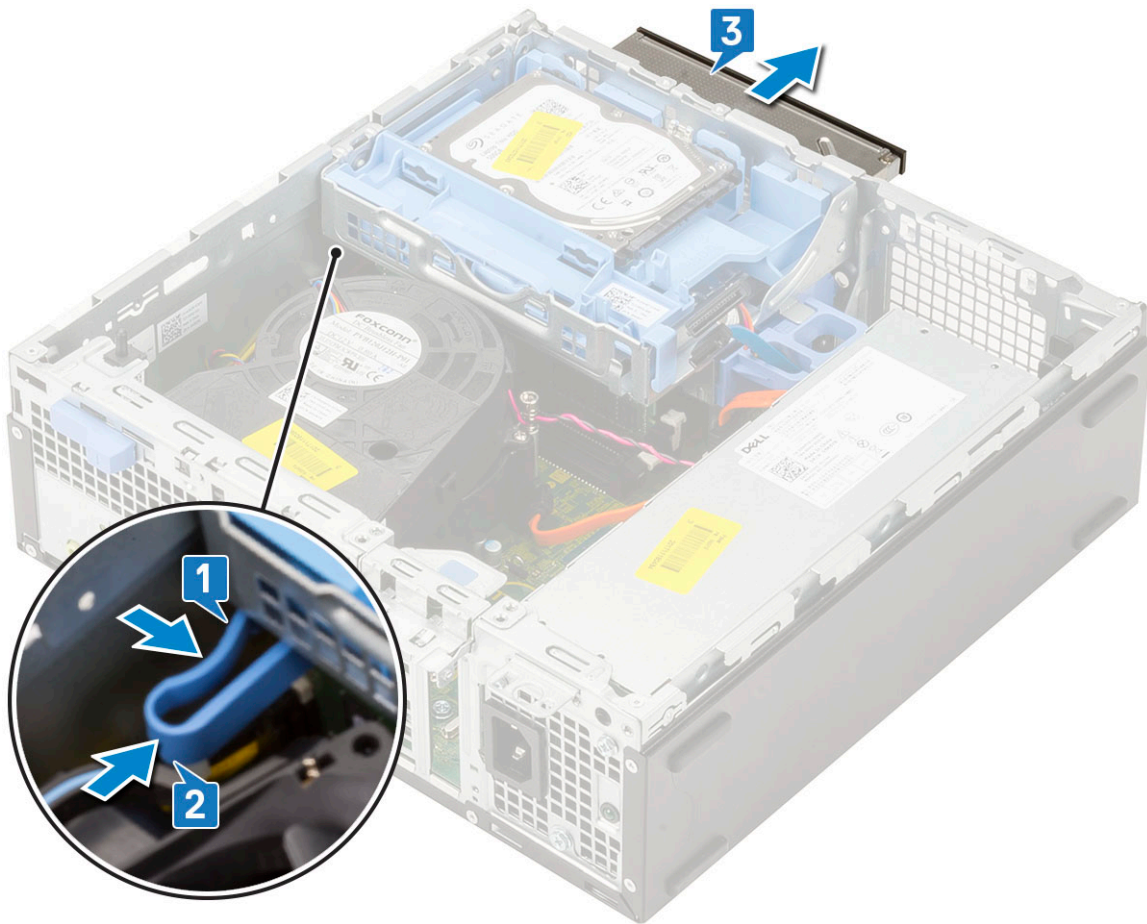
- b. リリースタブをスライドさせて、ハードドライブとオプティカルモジュールのロックを解除します [1]。
- c. ハードドライブとオプティカルモジュールを持ち上げます [2]。



- d. オプティカルドライブ データ ケーブルとオプティカルドライブ電源ケーブルをオプティカルドライブ [1、2] のコネクタから外し、ハードドライブとオプティカルモジュールが所定の位置に装着されるまで下ろします。

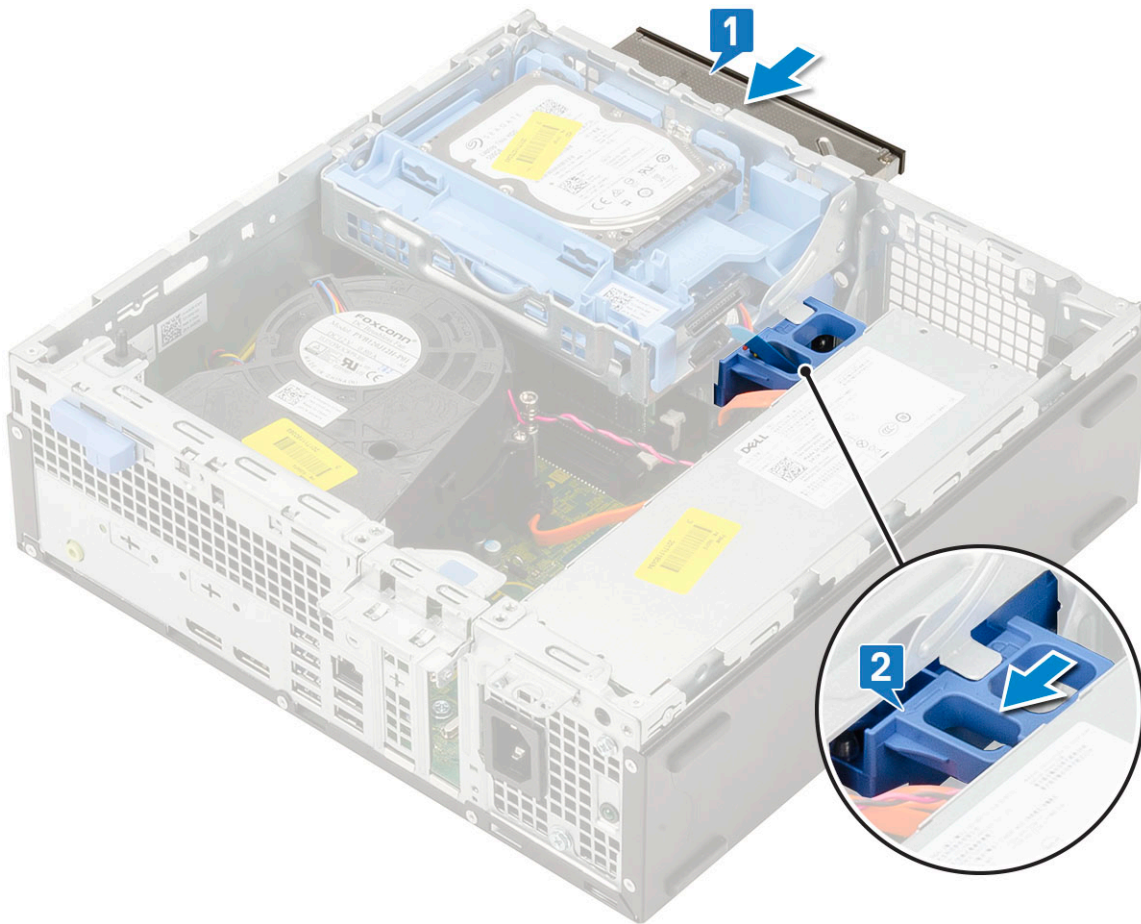


e. オプティカルドライブのリリース ラッチを押して [1]、オプティカルドライブをシステムから引き出します [3]。

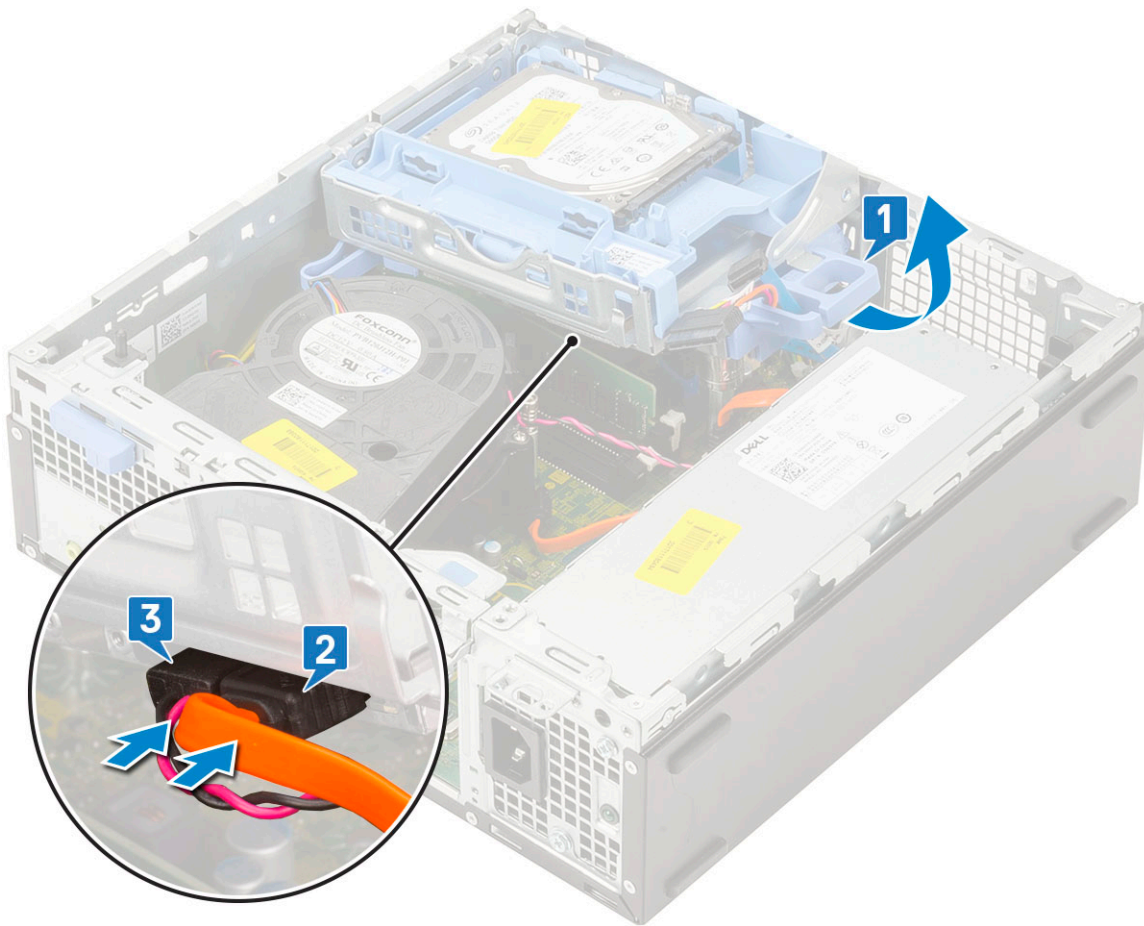


光学ドライブの取り付け

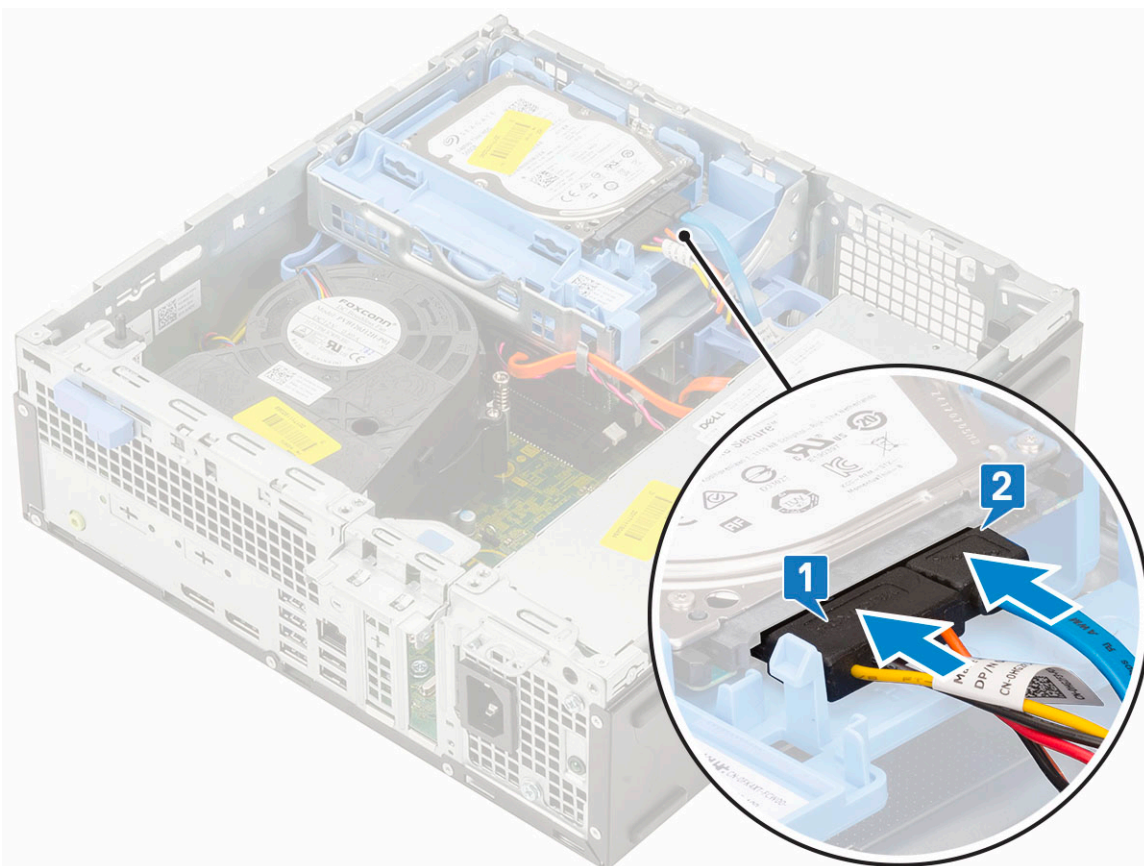
1. 光学ドライブをシステムのスロットに差し込みます [1]。
2. リリースタブをスライドさせて、ハードドライブと光学ドライブモジュールのロックを解除します [2]。



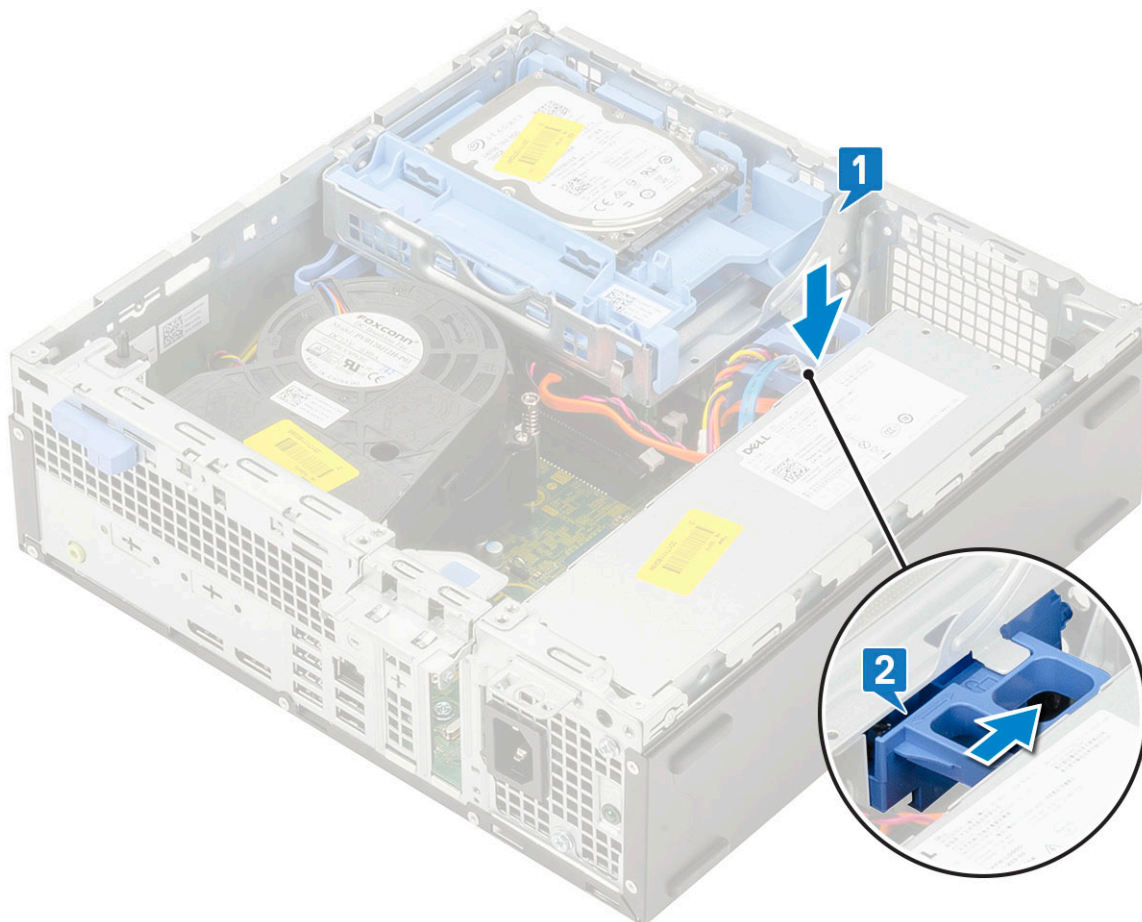
3. ハードドライブとオプティカルモジュールを持ち上げ [1]、オプティカルドライブデータケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブのコネクタに接続します [2、3]。



4. ハードドライブ データ ケーブルとハードドライブ電源ケーブルをハードドライブのコネクタに接続します [1、2]



5. リリースタブをスライドさせてモジュールをロックします [2]。

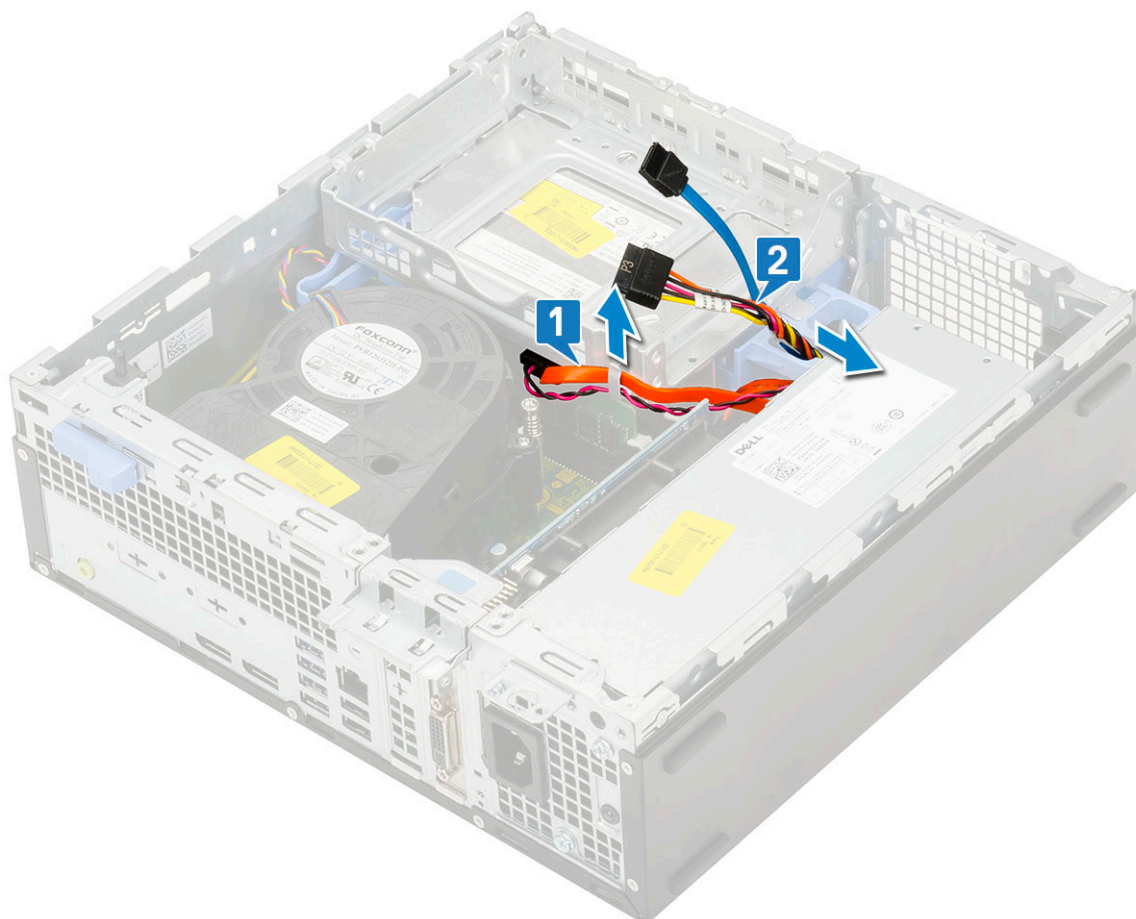


6. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. 前面ベゼル
 - b. サイドカバー
7. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

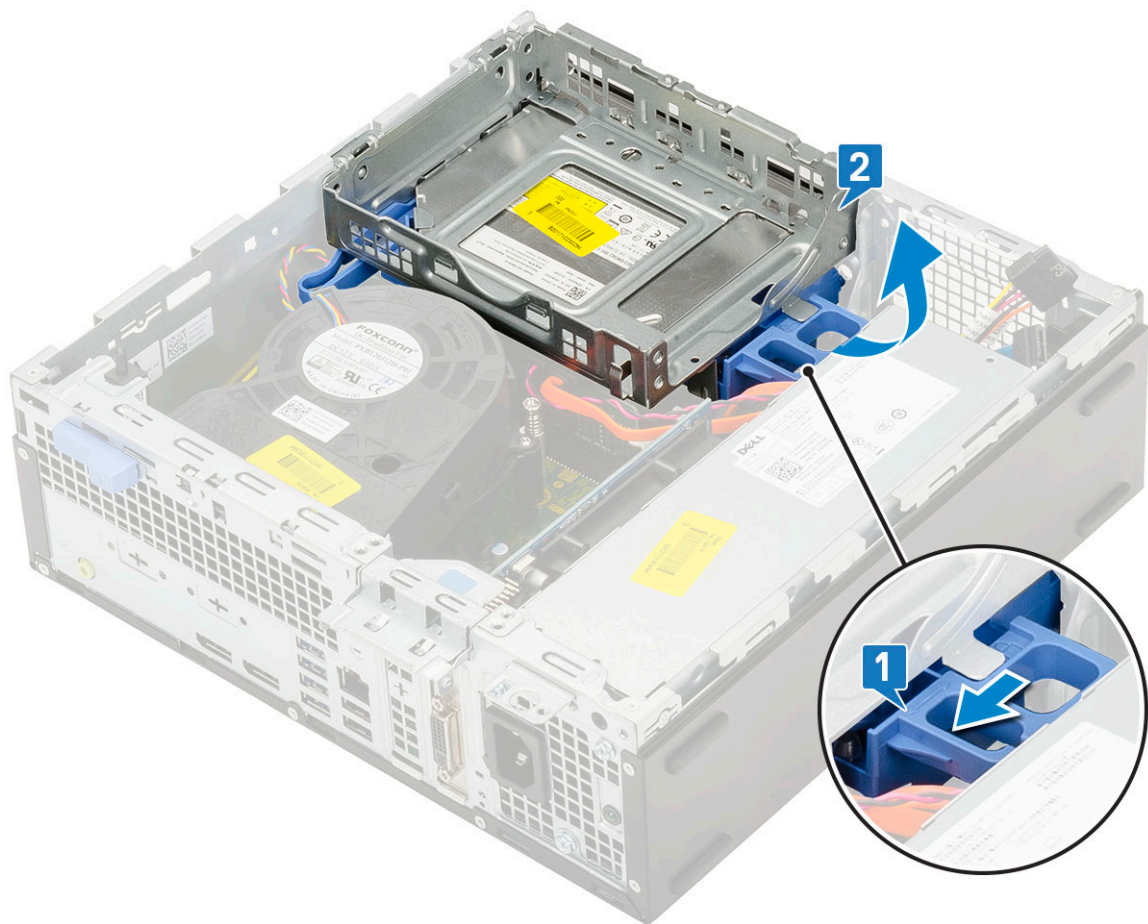
ハードドライブとオプティカルドライブモジュール

ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り外し

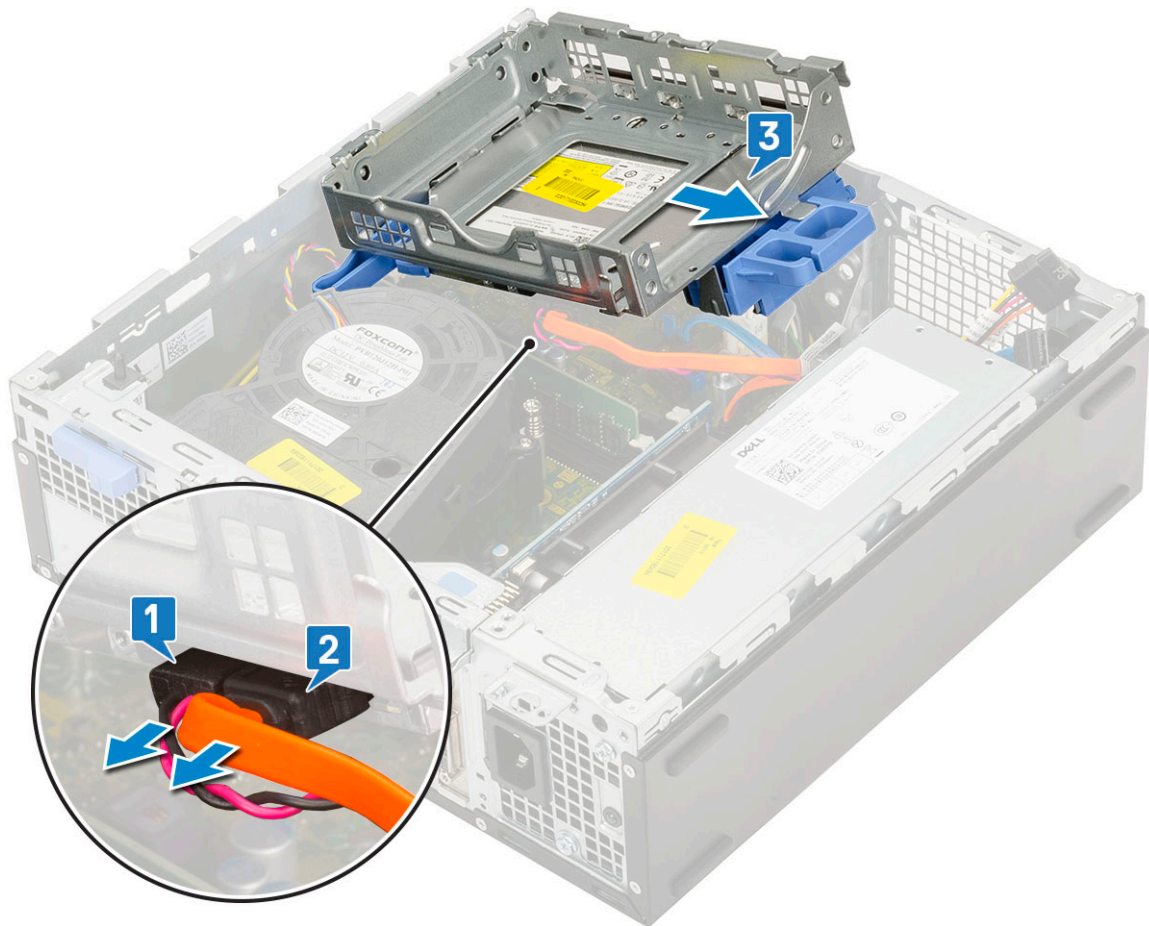
1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
3. ハードドライブとオプティカルドライブモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. オプティカルドライブケーブル [1] とハードドライブケーブル [2] の配線をそれぞれ固定クリップと HDD-ODD リリースタブを通して外します。



- b. リリースタブをスライドさせて、ハードドライブとオプティカルモジュールのロックを解除します [1]。
- c. ハードドライブとオプティカルモジュールを持ち上げます [2]。

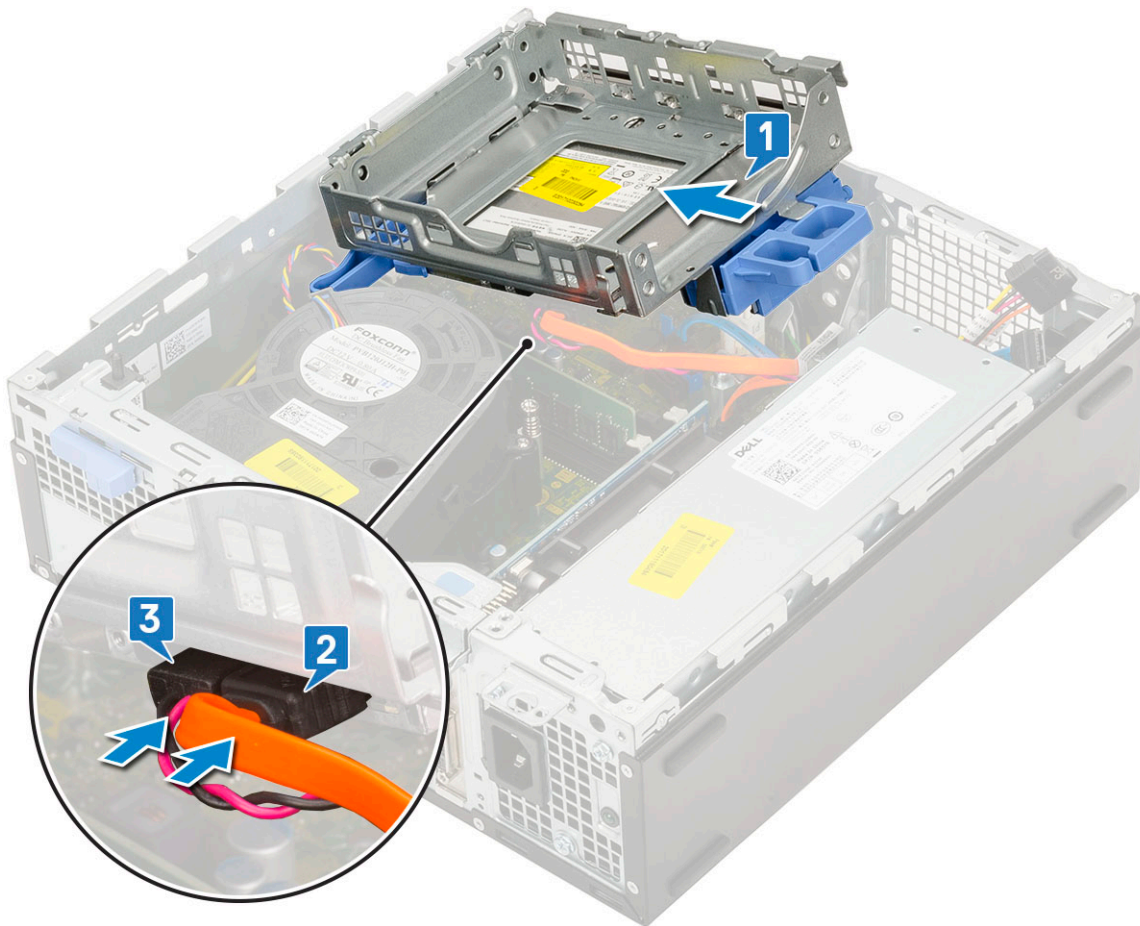


4. ハードドライブと光学ドライブモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. 光学ドライブデータケーブルと光学ドライブ電源ケーブルを光学ドライブのコネクタから外します [1, 2]。
 - b. ハードドライブをスライドさせて持ち上げ、システムから光学ドライブモジュールを取り外します [3]。

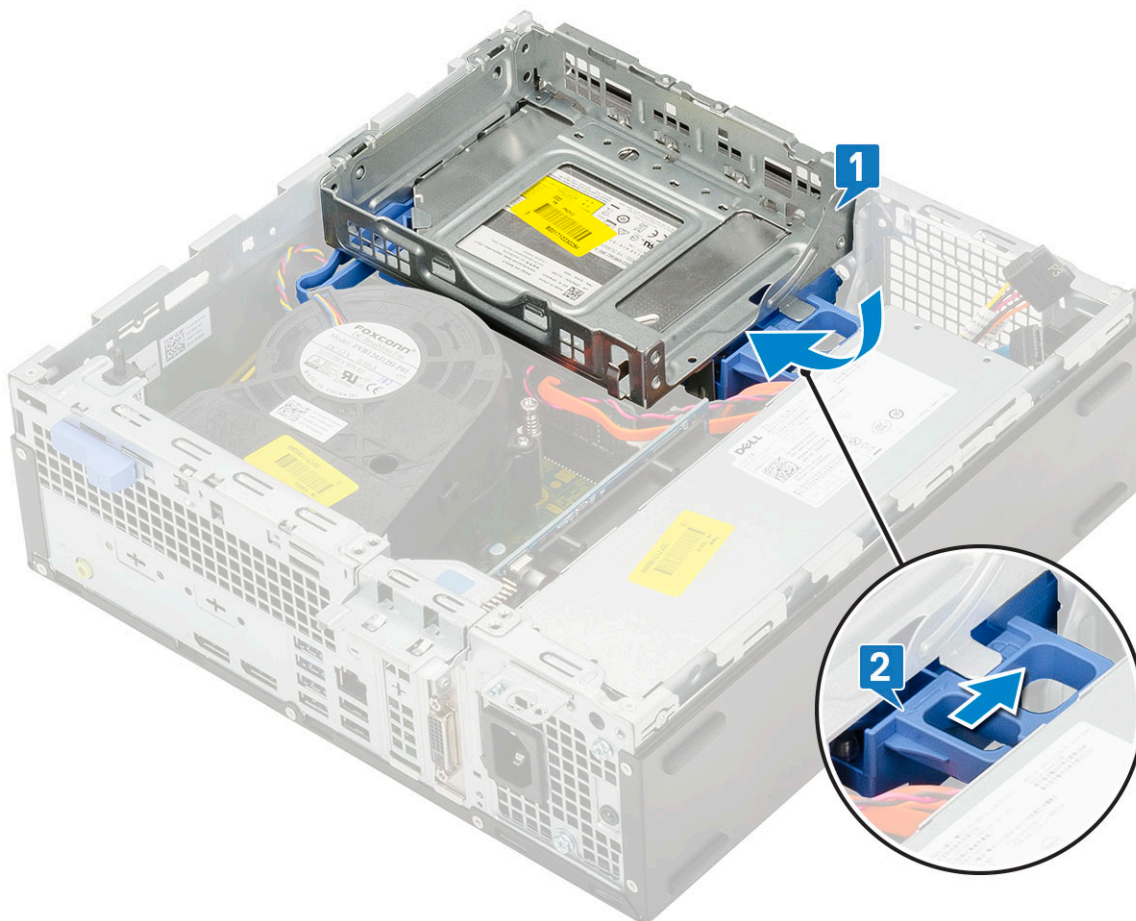


ハードドライブとオプティカルドライブモジュールの取り付け

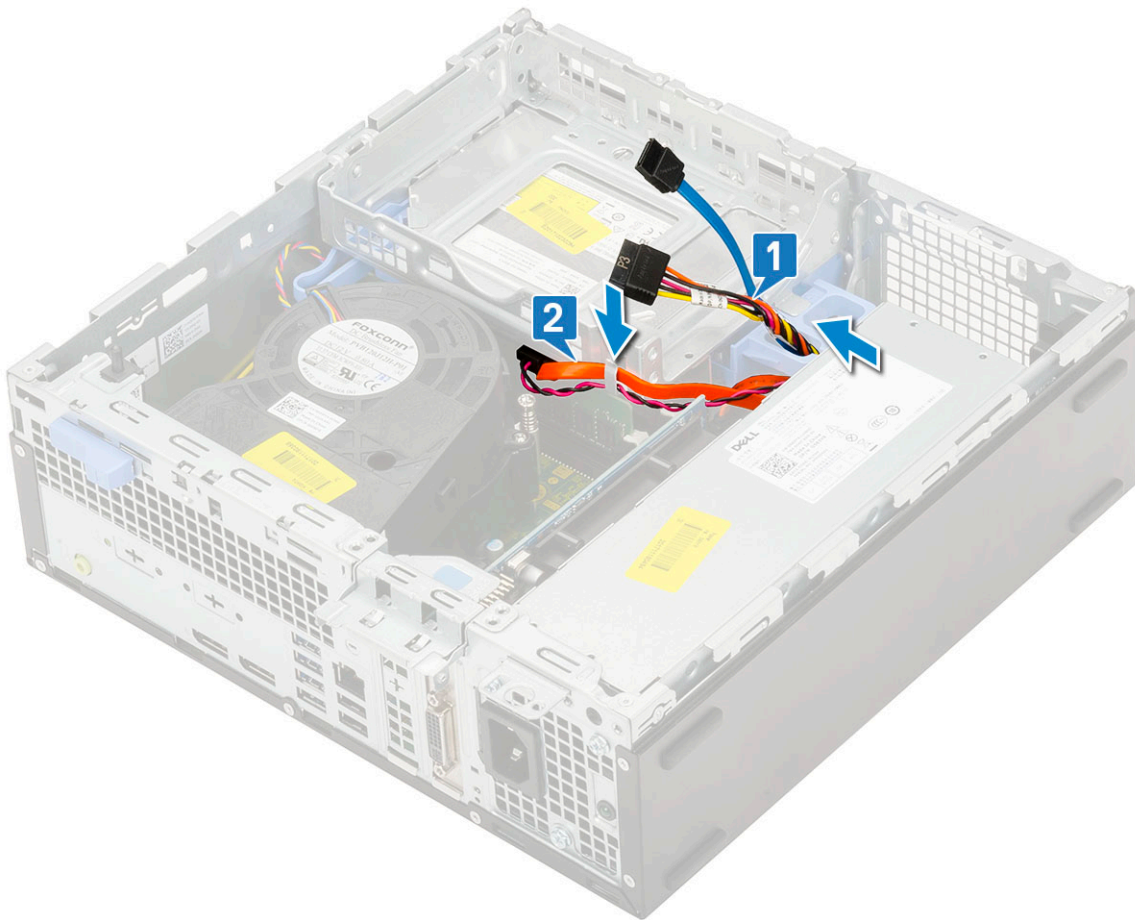
1. ハードドライブとオプティカルドライブモジュールのタブをシステムのスロットに30度の角度で挿入します [1]。
2. オプティカルドライブデータケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブのコネクタに接続します [2、3]。



3. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュールを下げてスロットに挿入します [1]。
4. リリースタブをスライドさせてモジュールをロックします [2]。



5. ハードドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを HDD-ODD リリースタブに通して配線します [1]。
6. オプティカルドライブ データ ケーブルと電源ケーブルを固定クリップに通して配線します [2]。

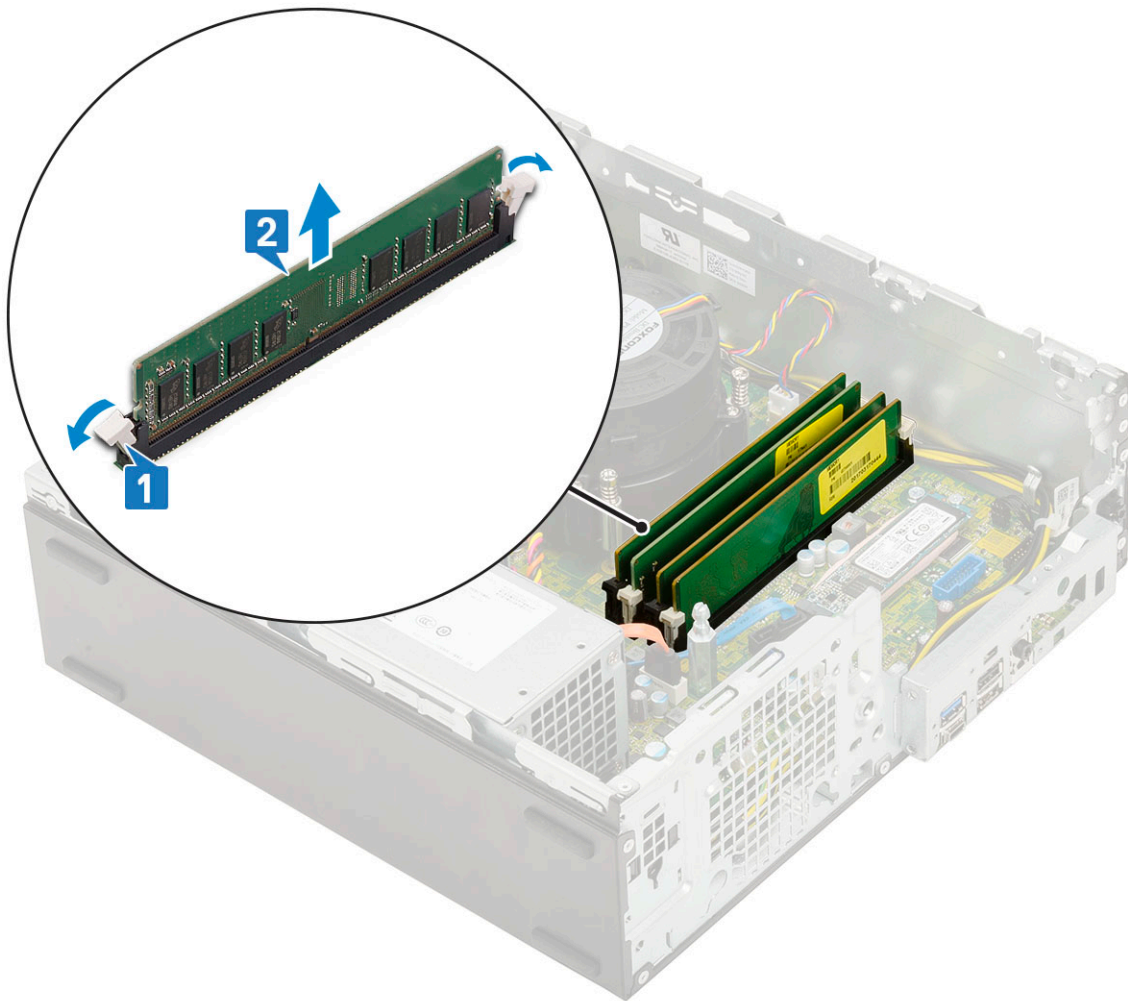


7. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ハードディスクドライブアセンブリ
 - b. 前面ベゼル
 - c. サイドカバー
8. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

メモリモジュール

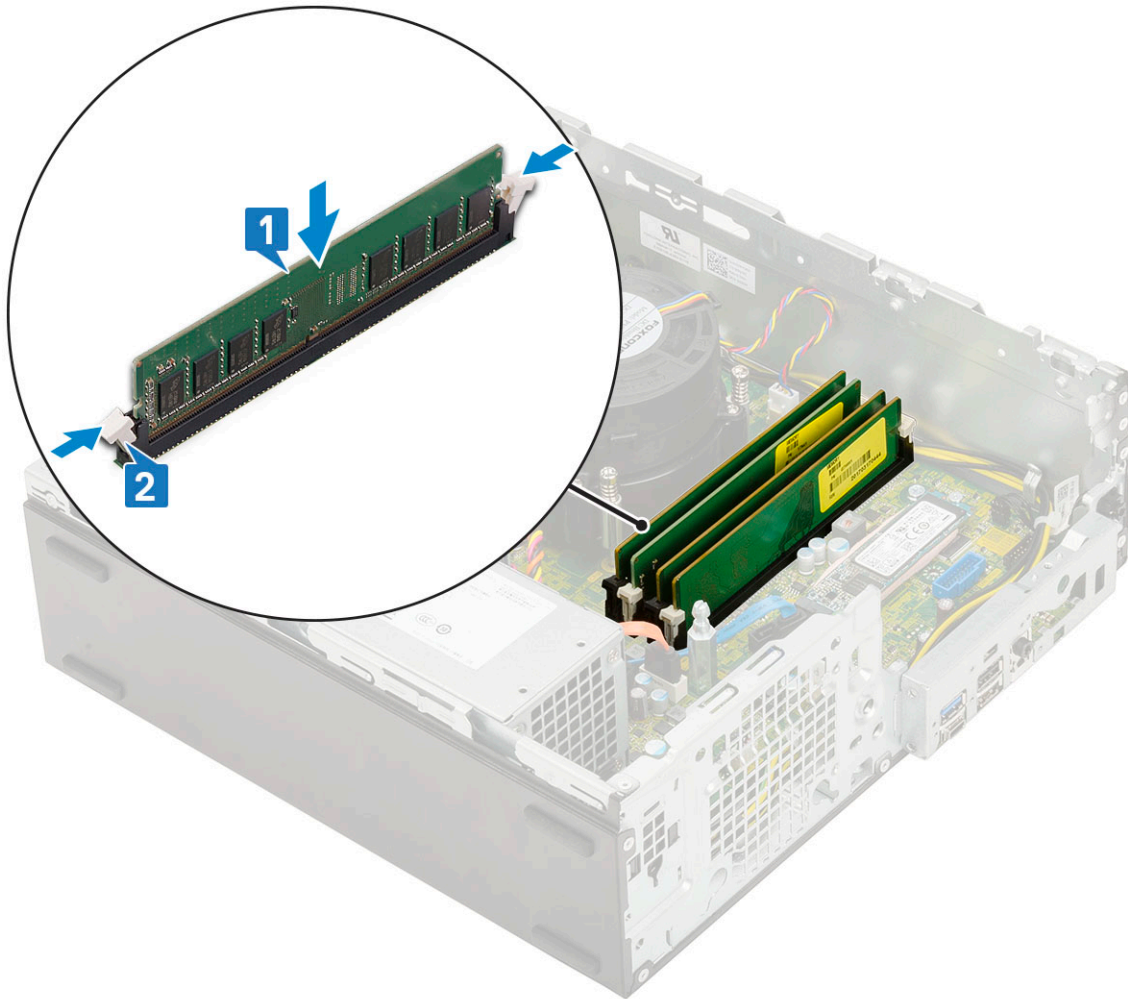
メモリモジュールの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブモジュール
3. メモリモジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. 固定タブを両側から持ち上げて、メモリモジュールをコネクタから持ち上げます [1]。
 - b. メモリモジュールをシステム基板から取り外します [2]。



メモリモジュールの取り付け

1. メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールコネクタのタブに合わせます。
2. メモリモジュールをメモリモジュールソケットに挿入します [1]。
3. メモリモジュールの固定タブが所定の位置にカチッと収まるまで、メモリモジュールを押し込みます [2]。

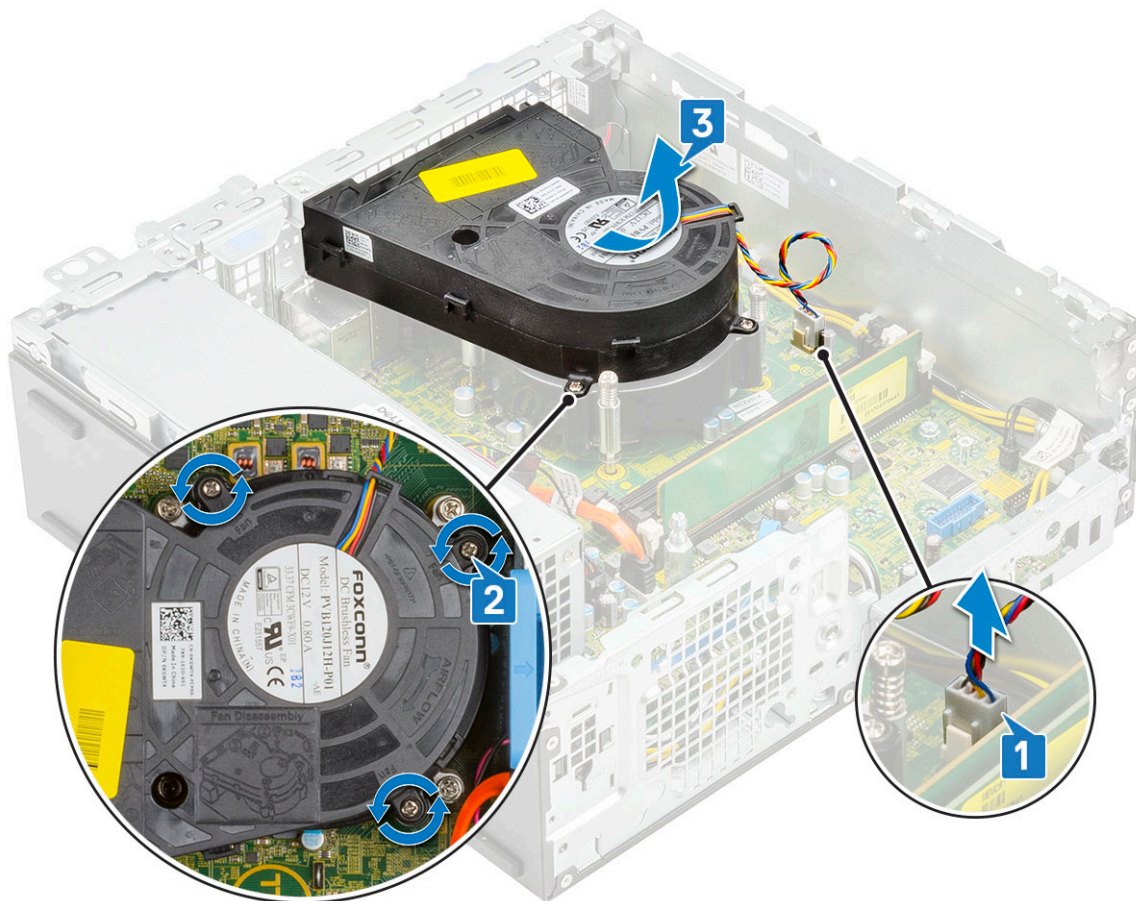


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - b. ハードディスクドライブ アセンブリ
 - c. 前面ベゼル
 - d. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ヒートシンク ファン

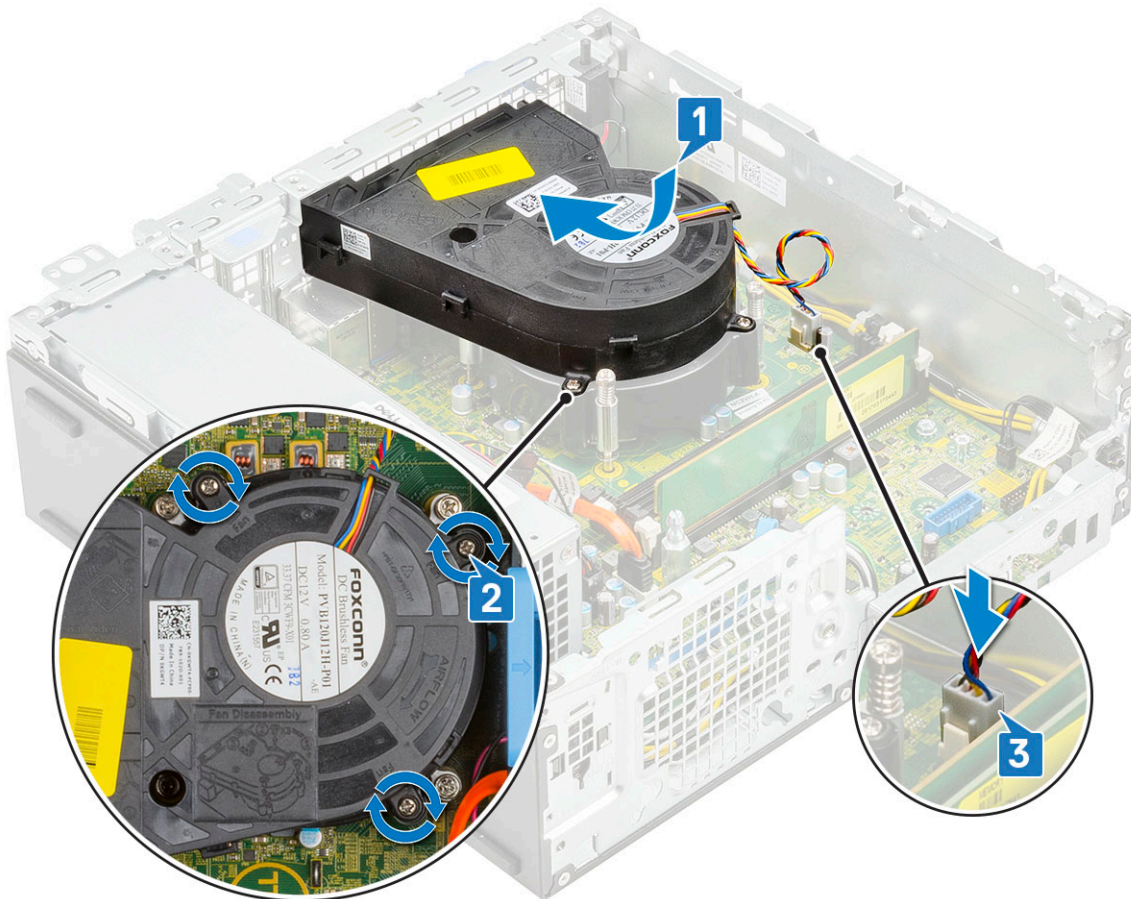
ヒートシンク ファンの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスクドライブ アセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
3. ヒートシンク ファンを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. ヒートシンク ファン ケーブルを、システム基板のコネクタから外します [1]。
 - b. ヒートシンク ファンをヒートシンクに固定している3本のネジを取り外します [2]。
 - c. ヒートシンク ファンを持ち上げてシステムから取り外します [3]。



ヒートシンクファンの取り付け

1. ヒートシンクの上で、ヒートシンクファンの位置を合わせます [1]。
2. 3本のネジを取り付けて、ヒートシンクファンをヒートシンクに固定します [2]。
3. ヒートシンクファンのケーブルを、システム基板のコネクタに接続します [3]。

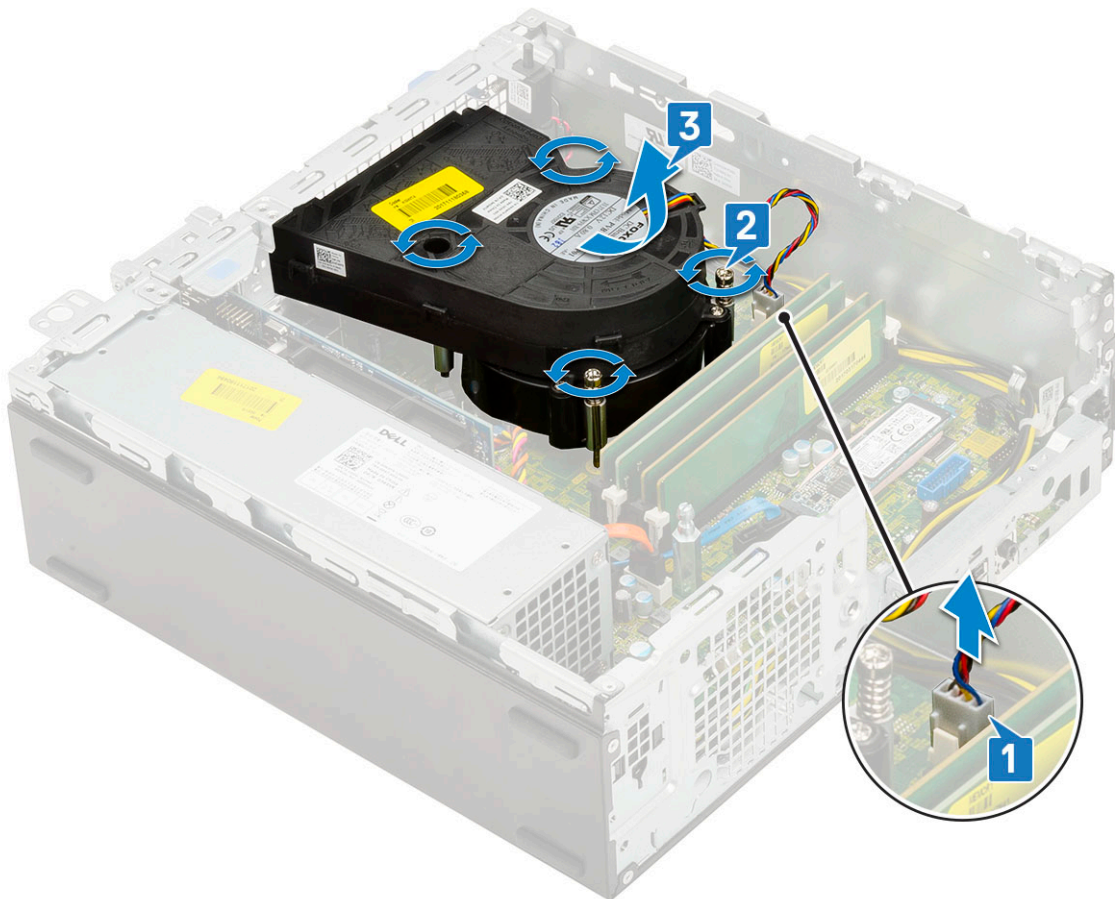


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - b. ハードディスクドライブアセンブリ
 - c. 前面ベゼル
 - d. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ヒートシンクアセンブリ

ヒートシンクアセンブリの取り外し

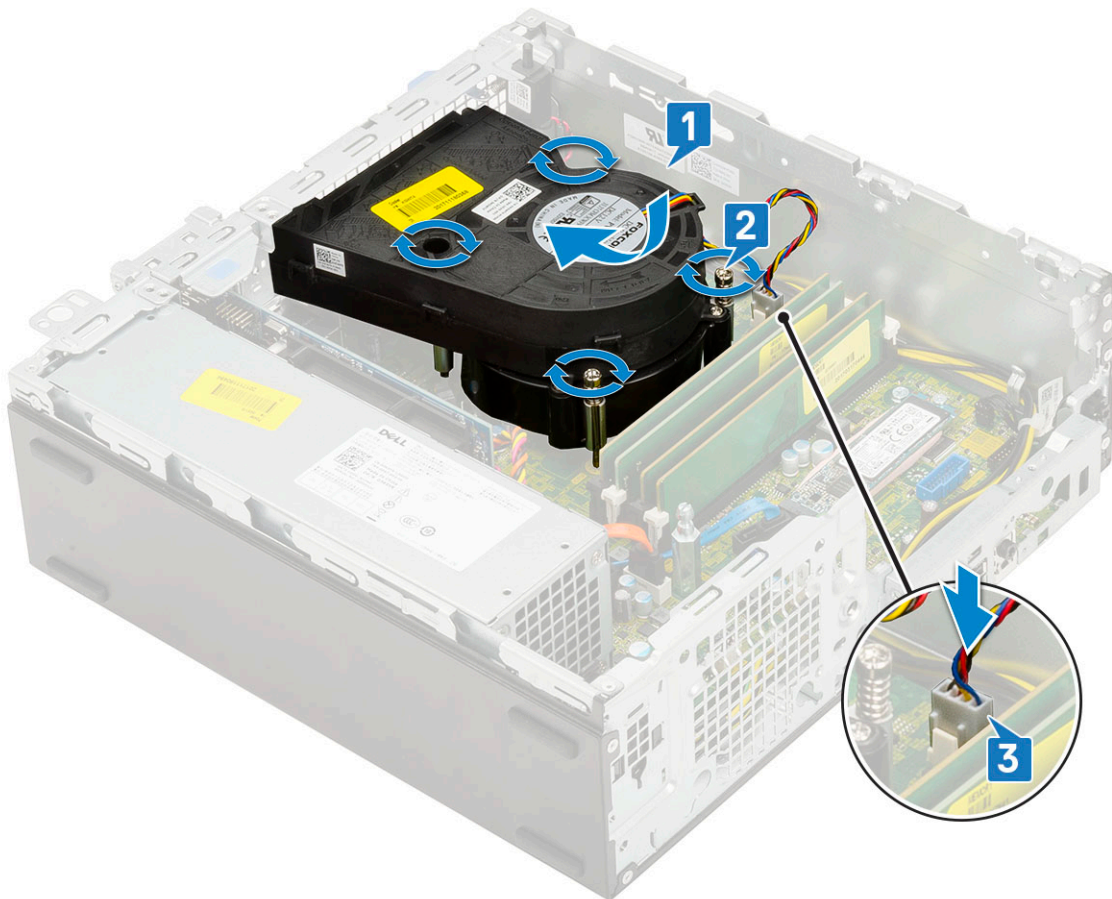
1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブモジュール
3. ヒートシンクアセンブリを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. システム基板のコネクタからヒートシンクアセンブリファンケーブルを外します [1]。
 - b. ヒートシンクアセンブリを固定している4本の拘束ネジを緩め [2]、ヒートシンクアセンブリを持ち上げてシステムから取り外します [3]。



① | メモ: システム基板上に表示されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを緩めます。

ヒートシンク アセンブリーの取り付け

1. ヒートシンク アセンブリーをプロセッサに合わせます [1]。
2. 4本の拘束ネジを締めて、ヒートシンク アセンブリーをシステム基板に固定します [2]。
① | メモ: システム基板に記載されているシーケンシャルな順序 (1、2、3、4) でネジを締めます。
3. ヒートシンク アセンブリーファン ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。

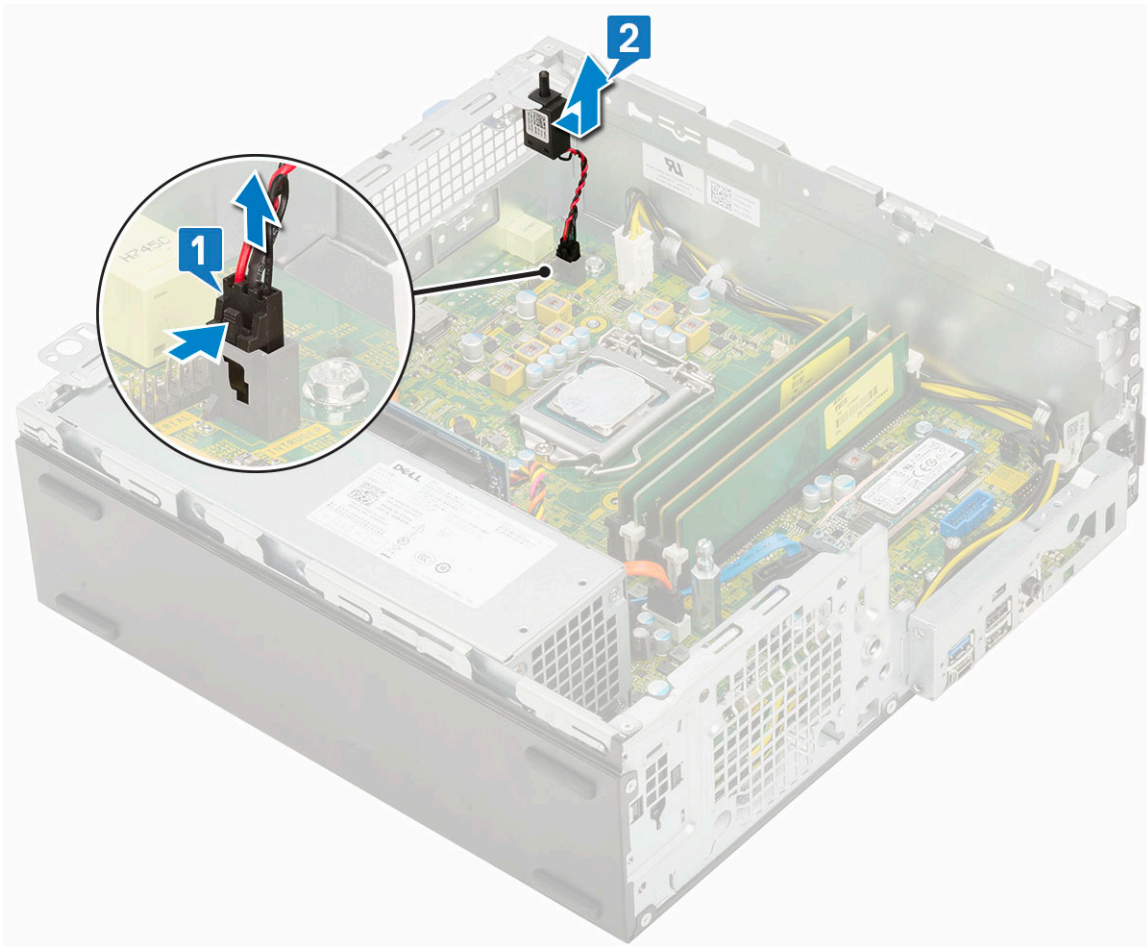


4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - b. ハードディスク ドライブ アセンブリ
 - c. 前面ベゼル
 - d. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

イントルージョンスイッチ

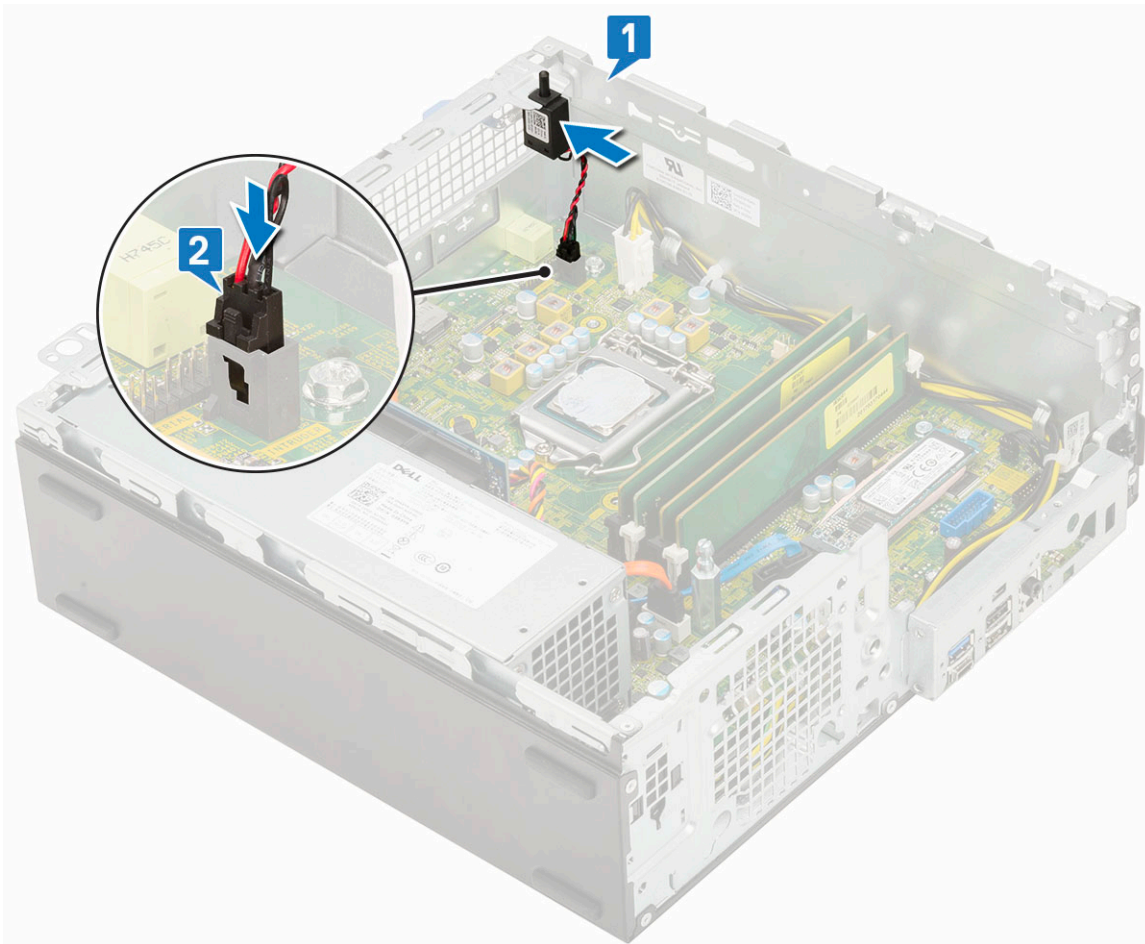
イントルージョン スイッチの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - e. ヒートシンクアセンブリ
3. イントルージョンスイッチを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板上のコネクタから外します [1]。
 - b. イントルージョン スイッチをスライドさせて持ち上げ、システムから取り外します [2]。



イントルージョンスイッチの取り付け

1. イントルージョン スイッチをシャーシのスロットに挿入します [1]。
2. イントルージョン スイッチ ケーブルをシステム基板に接続します [2]。

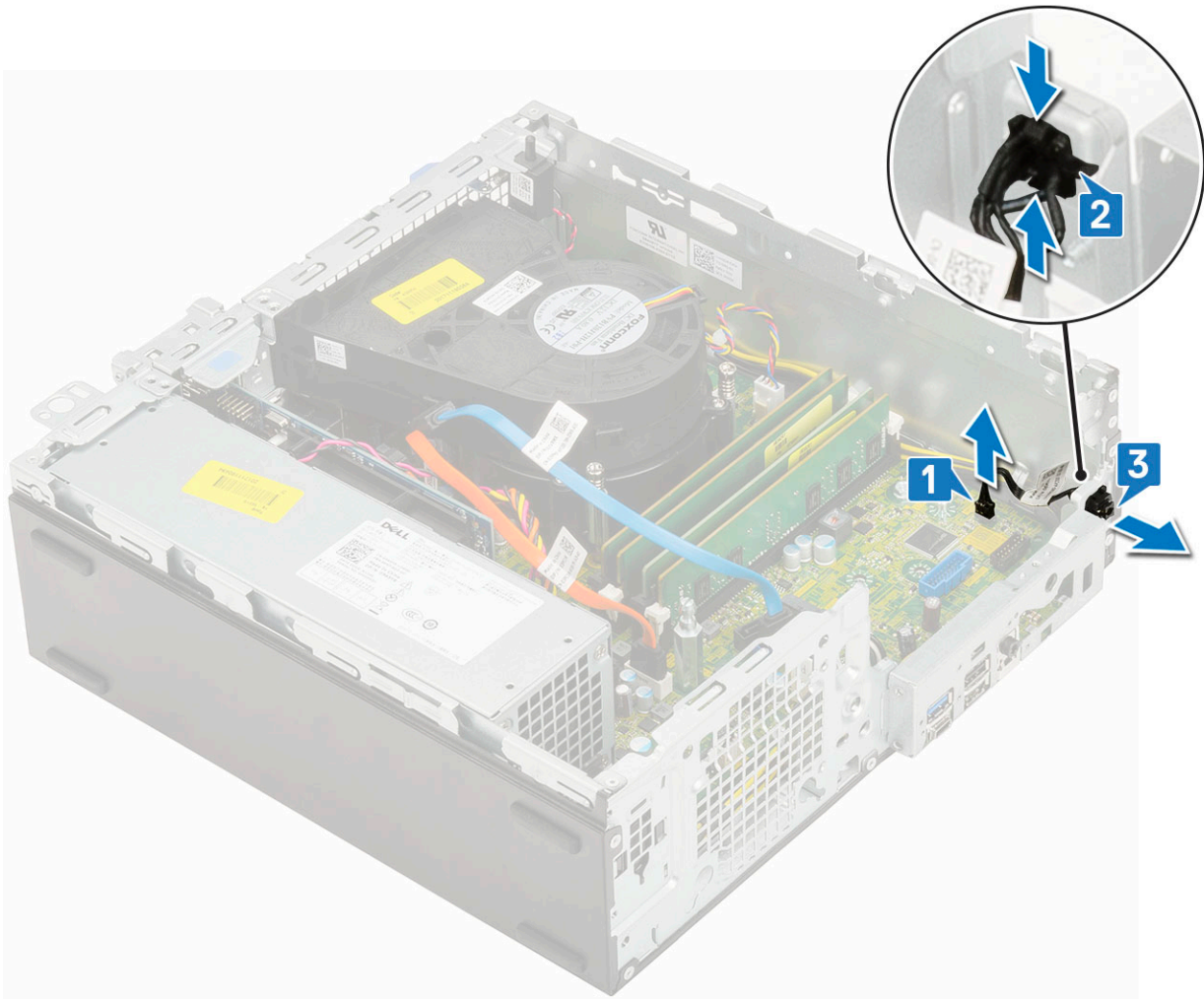


3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ヒートシンクアセンブリ
 - b. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
 - d. 前面ベゼル
 - e. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源スイッチ

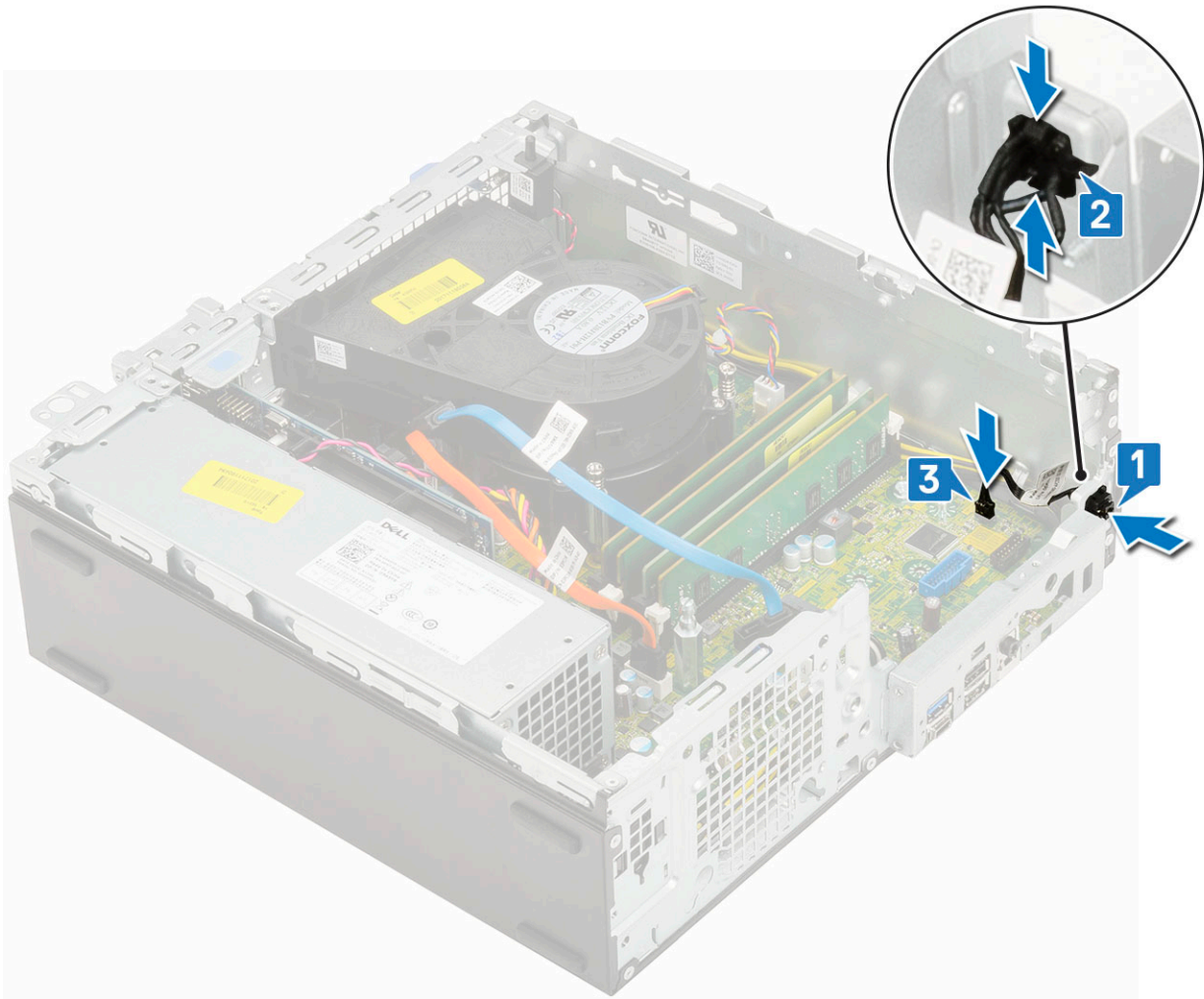
電源スイッチの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
3. 電源スイッチを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. 電源スイッチケーブルをシステム基板から外します [1]。
 - b. 電源スイッチ固定タブを押して、電源スイッチをシステムから取り外します [2][3]。



電源スイッチの取り付け

1. 電源スイッチ モジュールをスライドさせてカチッと所定の位置に収まるまでシャーシのスロットに差し込みます [1, 2]。
2. 電源スイッチ ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。

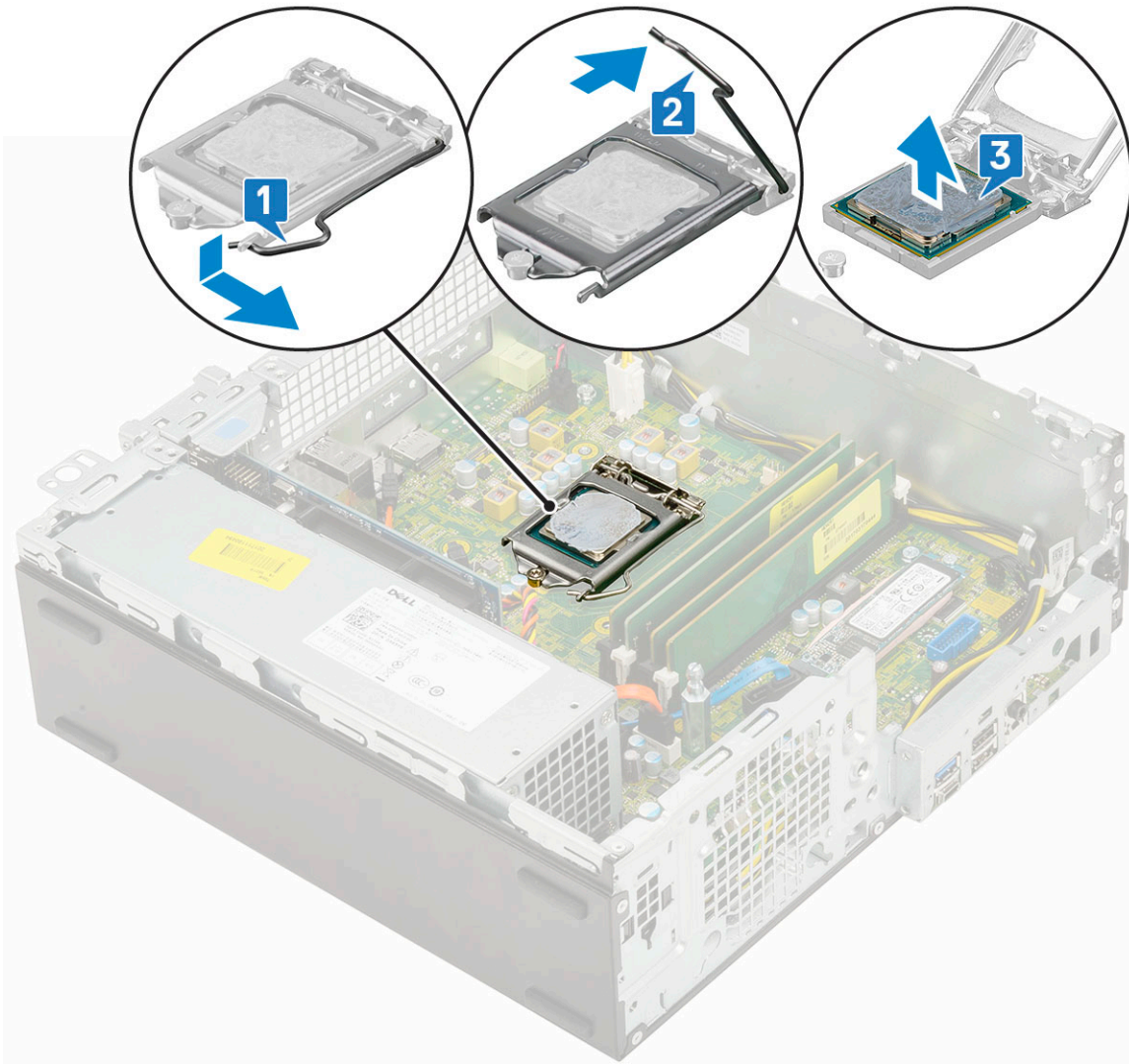


3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - b. ハードディスクドライブアセンブリ
 - c. 前面ベゼル
 - d. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

プロセッサ

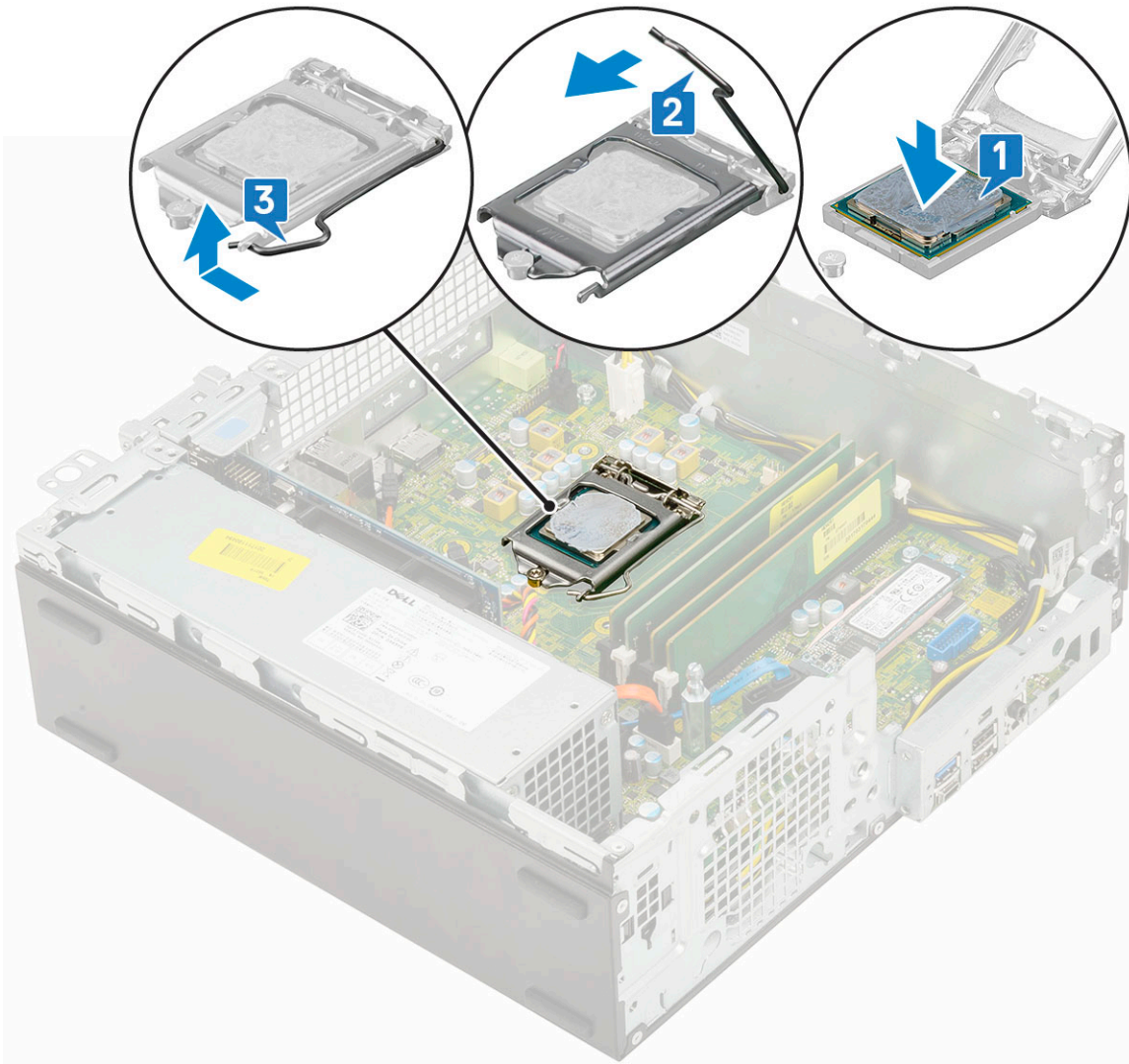
プロセッサの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. HDD アセンブリ
 - d. ハードドライブと光ドライブ モジュール
 - e. ヒートシンクアセンブリ
3. プロセッサを取り外すには：
 - a. レバーを押し下げてプロセッサシールドのタブの下からソケットレバーを外します [1]。
 - b. レバーを持ち上げて、プロセッサシールドを持ち上げます [2]。
 - c. プロセッサを持ち上げて、ソケットから外します [3]。



プロセッサの取り付け

1. プロセッサのロットがソケット キーに合うように、プロセッサをソケットに置きます [1]。
2. プロセッサ シールドを固定ネジの下にスライドさせて閉じます [2]。
3. ソケット レバーを下げてタブの下に押し込んでロックします [3]。



4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ヒートシンクアセンブリ
 - b. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
 - d. 前面ベゼル
 - e. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

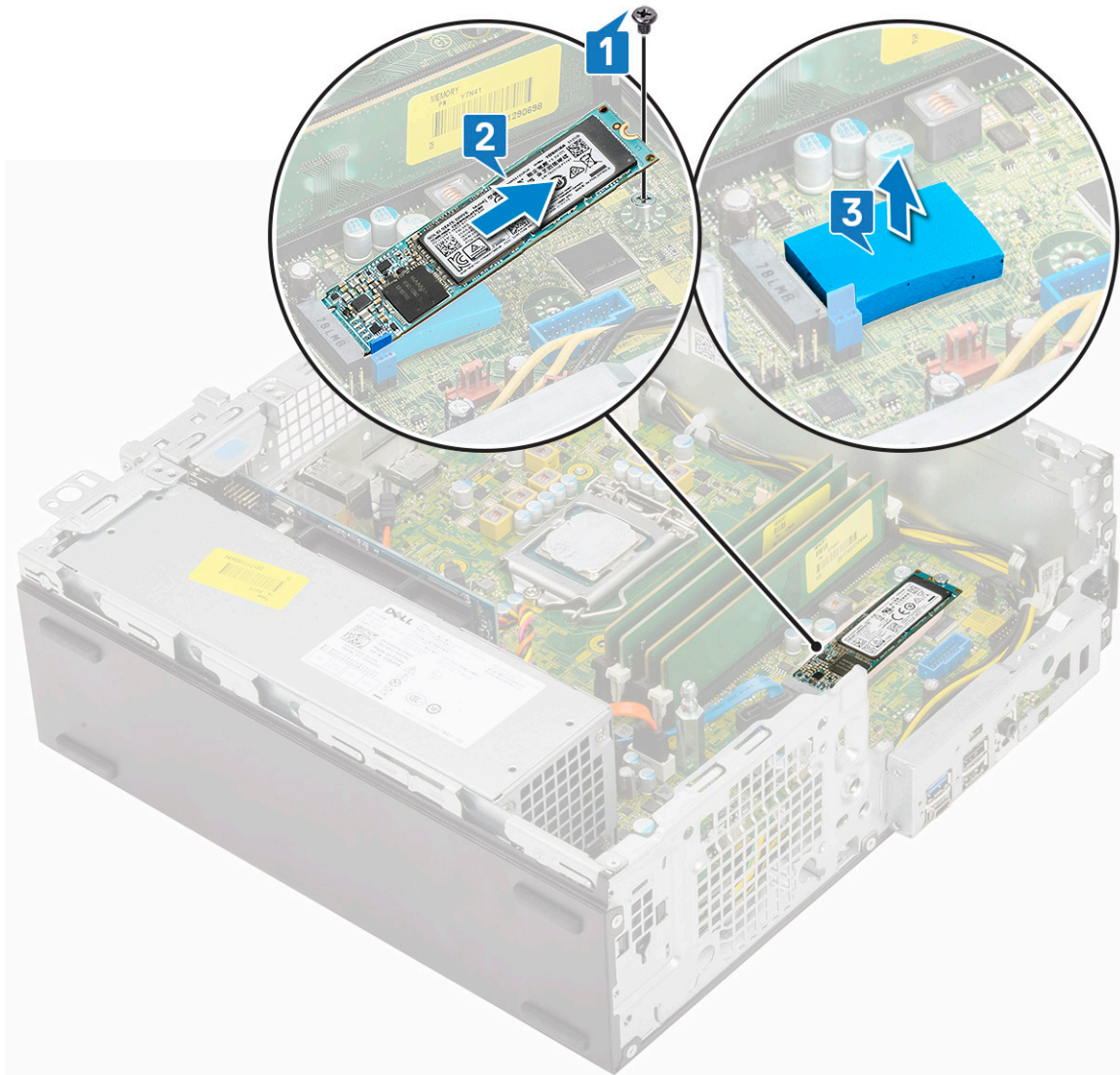
M.2 PCIe SSD

M.2 PCIe SSD の取り外し

メモ: 以下の手順は、M.2 SATA SSDにも適用されます。

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - e. ヒートシンクアセンブリ

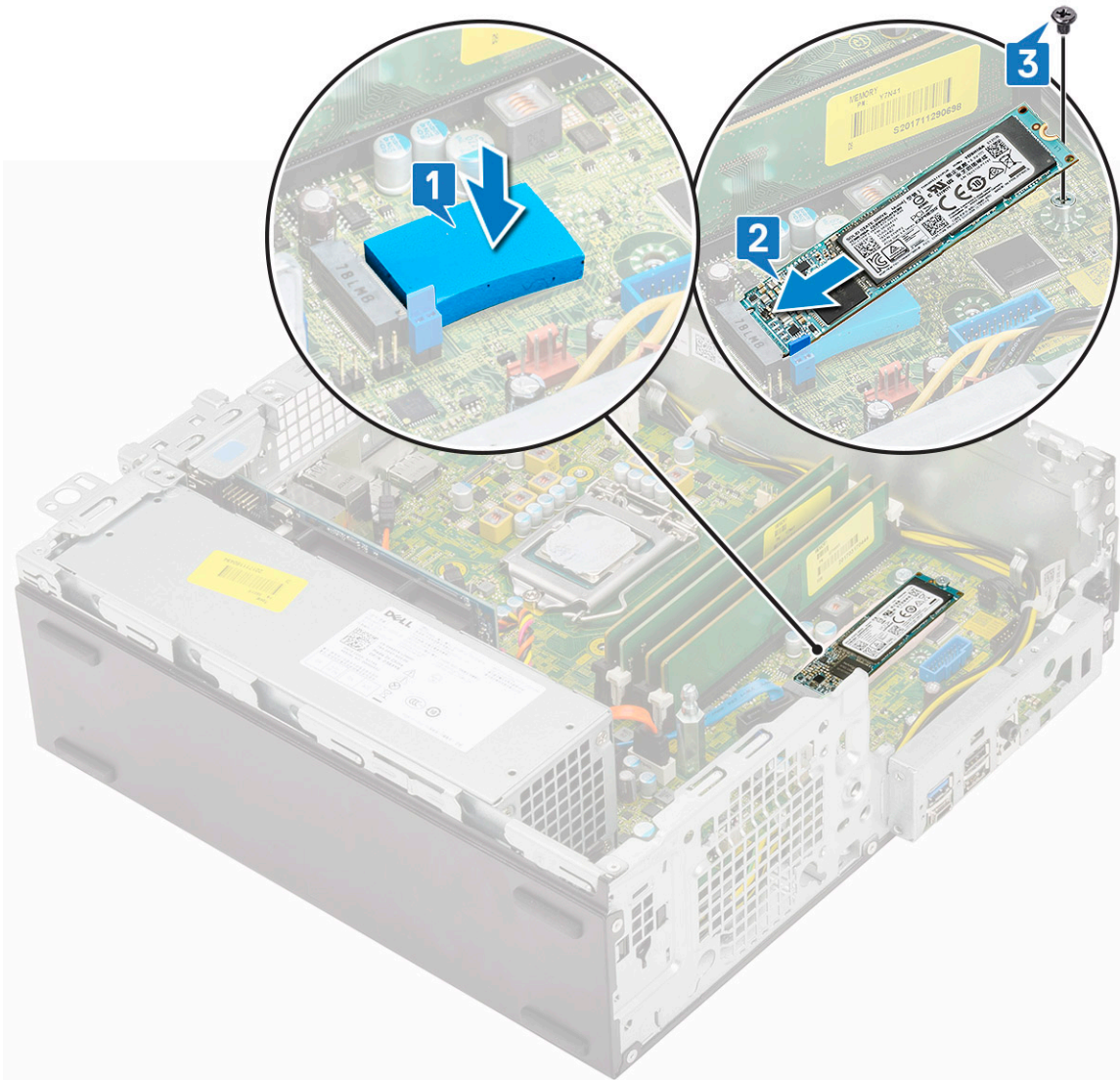
3. M.2 PCIe SSD を取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. M.2 PCIe SSD をシステム基板に固定している 1 本の (M2x3.5) ネジを取り外します [1]。
 - b. システム基板のコネクタから PCIe SSD を持ち上げて引き出します [2]。
 - c. SSD サーマルパッドを取り外します [3]。



M.2 PCIe SSD の取り付け

メモ: 以下の手順は、M.2 SATA SSD にも適用されます。

1. SSD サーマルパッドをシステム基板のスロットにセットします [1]。
2. M.2 PCIe SSD をシステム基板のコネクタに挿入します [2]。
3. M.2 PCIe SSD をシステム基板に固定する 1 本の (M2x3.5) ネジを取り付けます [3]。



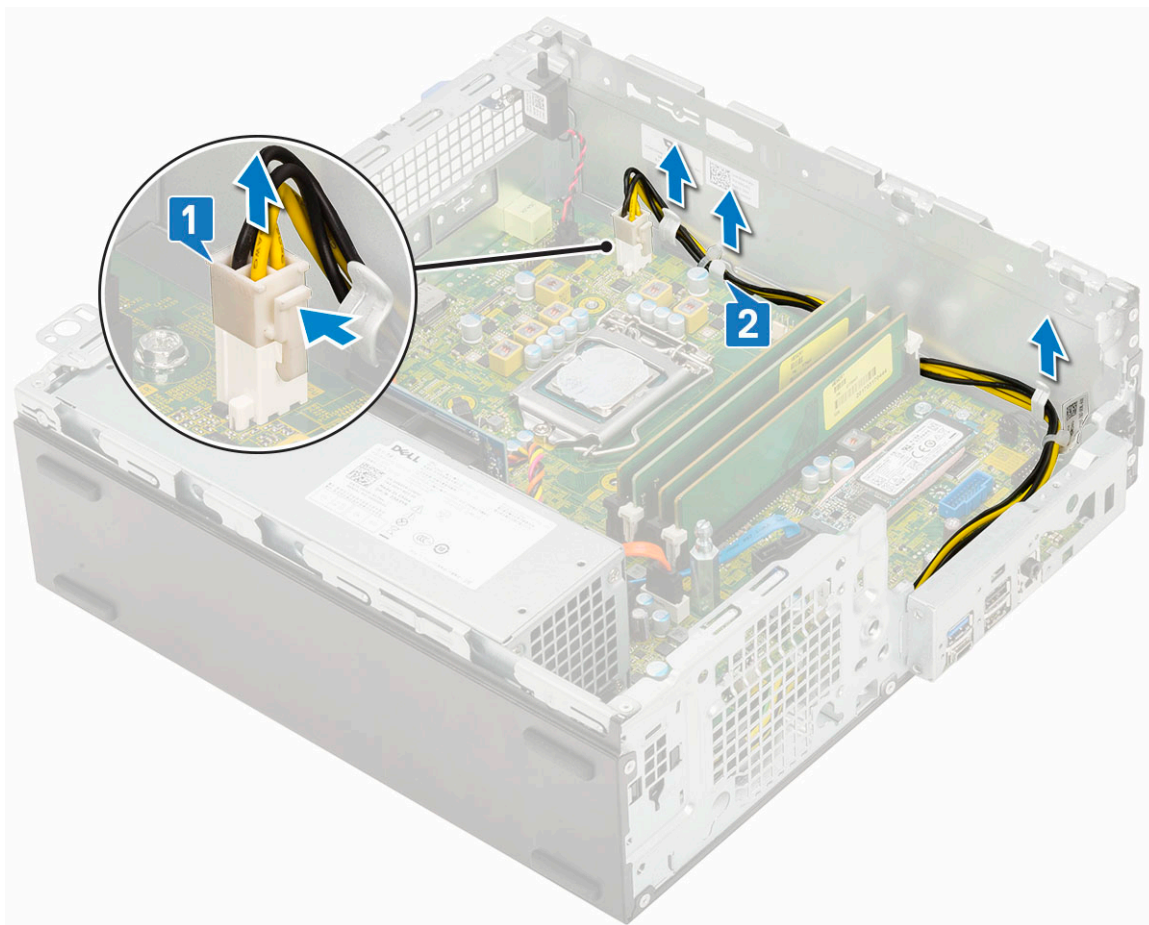
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ヒートシンクアセンブリ
 - b. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - c. ハードディスク ドライブ アセンブリ
 - d. 前面ベゼル
 - e. サイドカバー
5. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源装置ユニット

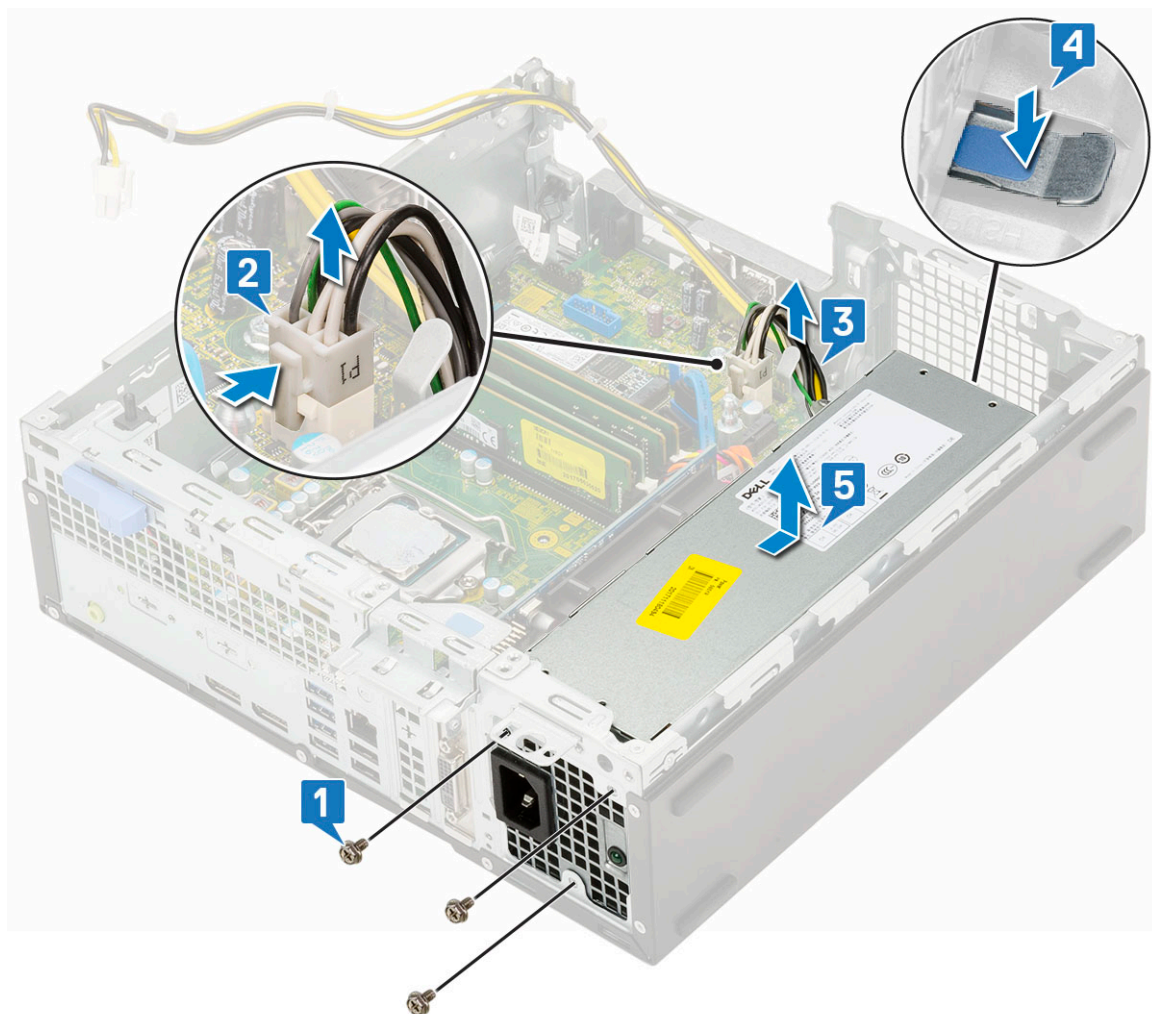
PSU (電源供給ユニット) の取り外し

1. 「PC 内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. HDD アセンブリー
 - d. ハードドライブと光学ドライブ モジュール
 - e. ヒートシンク アセンブリー

3. PSU を外すには、次の手順を実行します。
- a. CPU 電源ケーブルをシステム ボードから取り外します [1]。
 - b. 電源ケーブルの配線をシャーシの固定クリップから外します [2]。

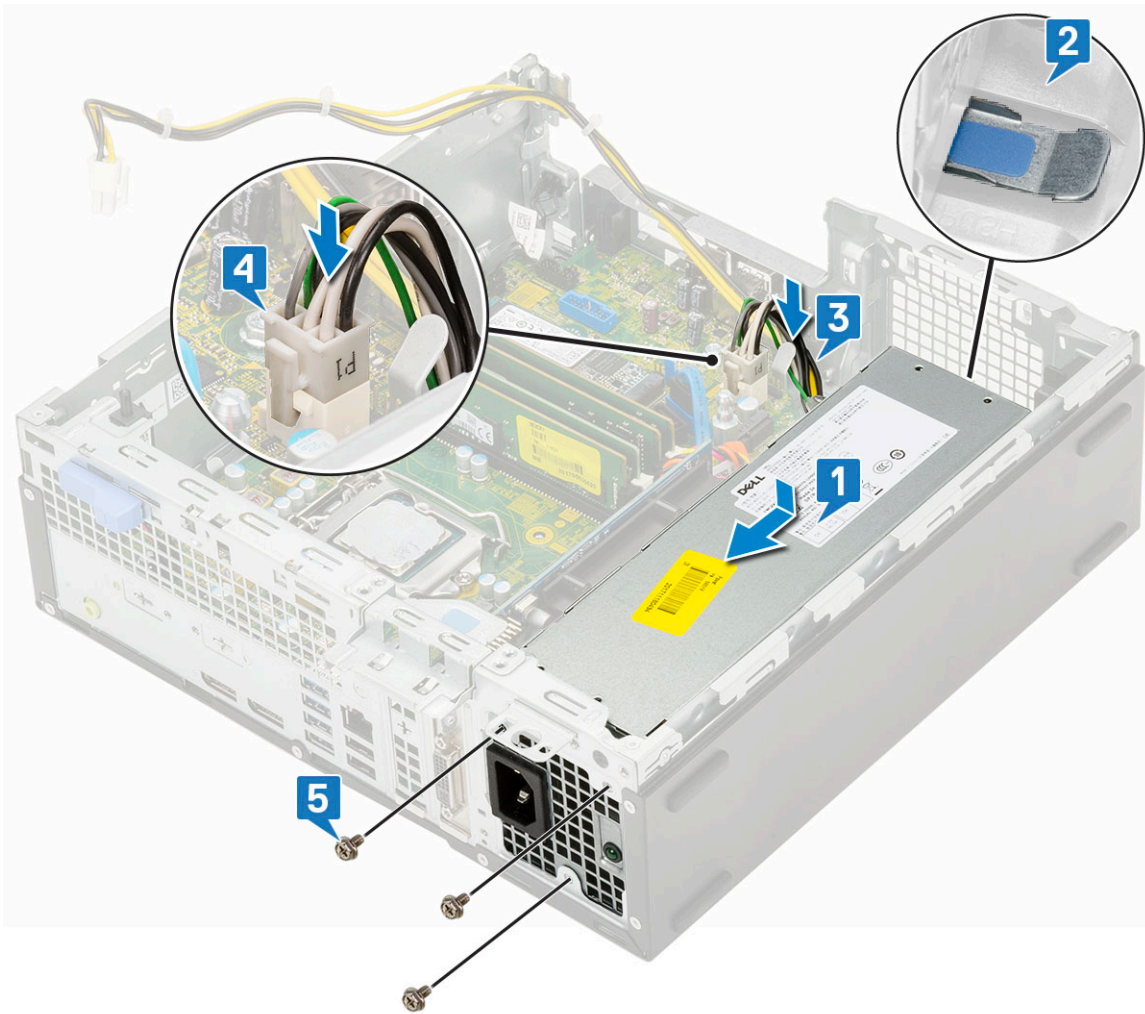


4. PSU を取り外すには、次の手順を実行します。
- a. PSU をシステムに固定している 3 本のネジを外します [1]。
 - b. システム電源ケーブルをシステム ボードのコンネクターから外します [2]。
 - c. ケーブルを持ち上げて、システムから取り外します [3]。
 - d. PSU ユニットの後部にある青色のリリース タブを押し [4]、PSU をスライドさせて持ち上げ、システムから取り外します [5]。

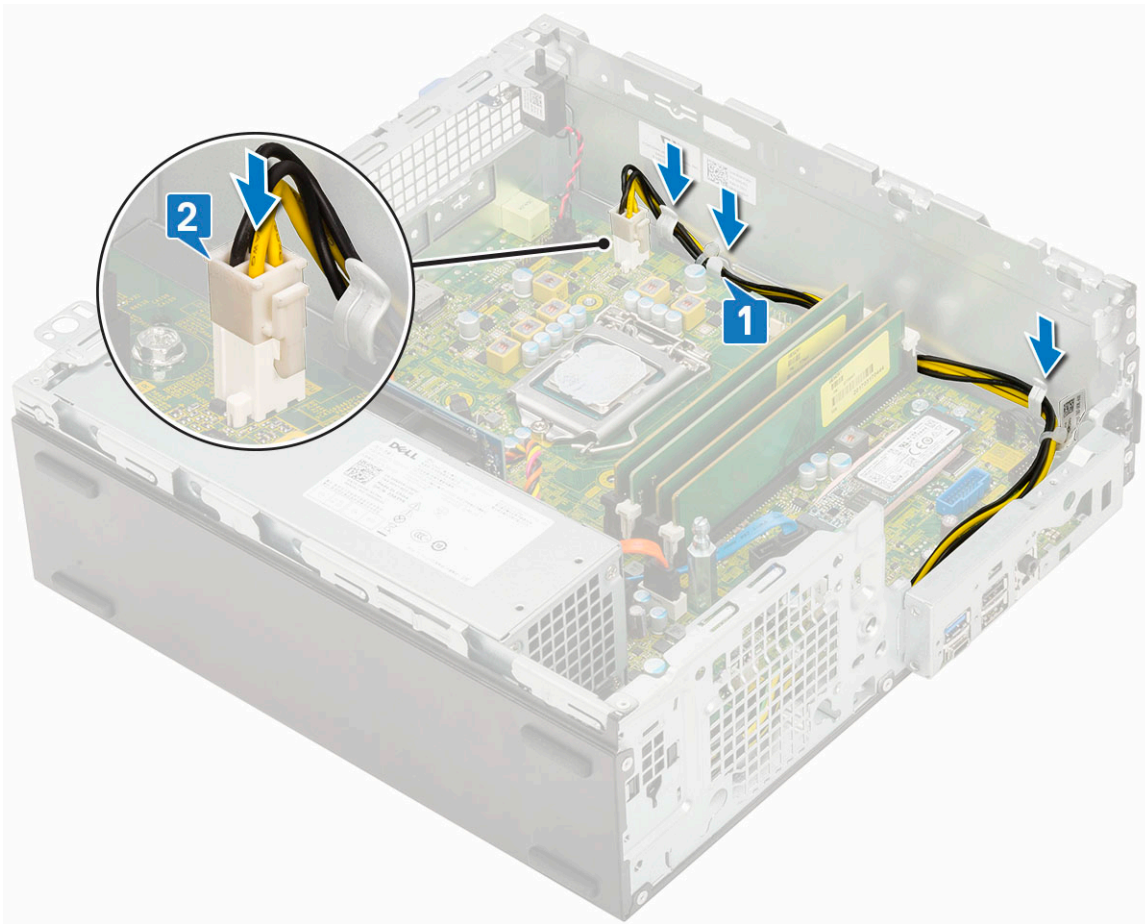


PSU (電源装置ユニット) の取り付け

1. PSU をシャーシに挿入し、システムの背面に向かってスライドさせて固定します [1、2]。
2. システム電源ケーブルを固定クリップに通して配線します [3]。
3. 電源ケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [4]。
4. ネジを取り付けて、PSU をシステムの背面シャーシに固定します [5]。



5. CPU 電源ケーブルを固定クリップに通して配線します [1]。
6. CPU 電源ケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します [2]。

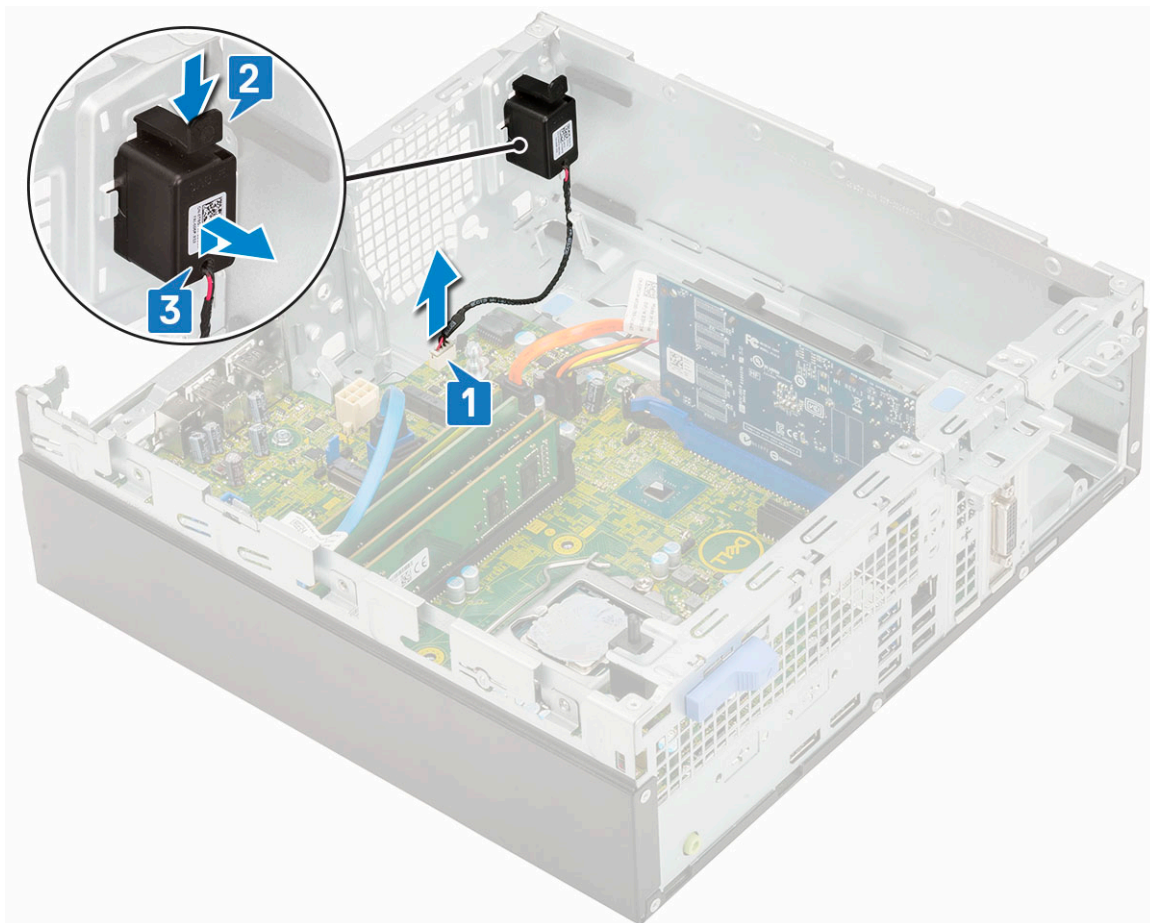


7. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. ヒートシンクアセンブリ
 - b. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
 - d. 前面ベゼル
 - e. サイドカバー
8. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

スピーカー

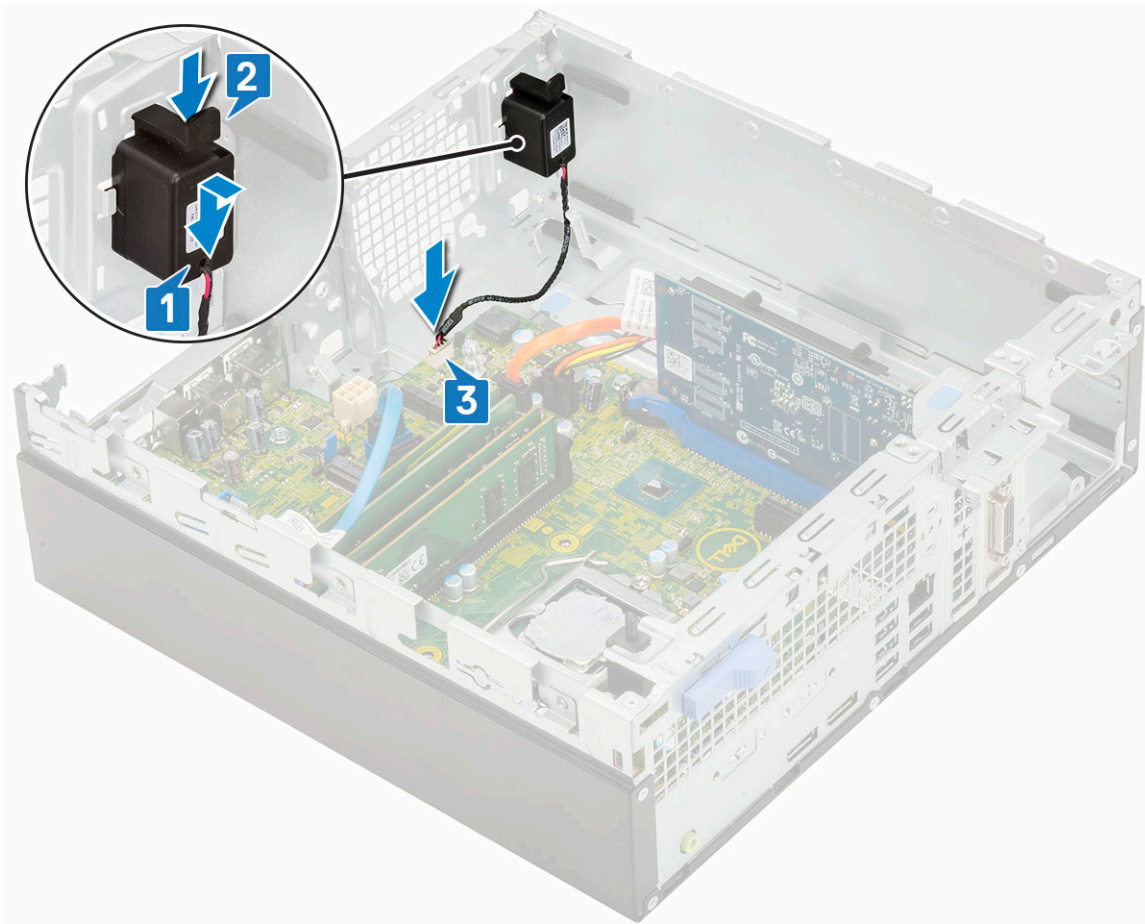
スピーカーの取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - e. ヒートシンクアセンブリ
 - f. PSU
3. スピーカーを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタから外します [1]。
 - b. リリースタブを押し [2]、システムからスピーカーを引き出します [3]。



スピーカーの取り付け

1. スピーカーをシステムシャーシのスロットに挿入し、カチッと所定の位置に収まるまで押し込みます [1、2]。
2. スピーカーケーブルをシステム基板のコネクタに接続します [3]。



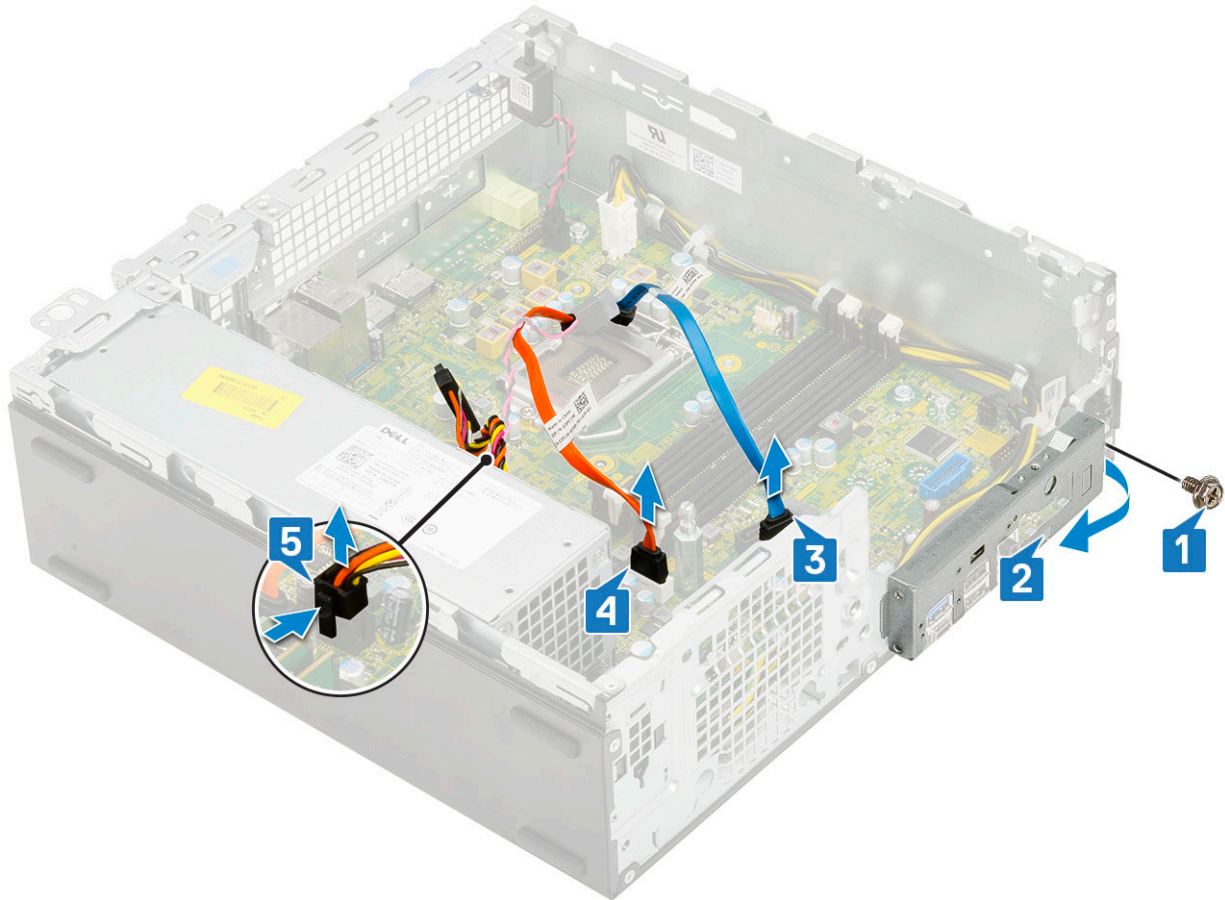
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a. PSU
 - b. ヒートシンクアセンブリ
 - c. ハードディスクドライブアセンブリ
 - d. ハードドライブとオプティカルドライブモジュール
 - e. 前面ベゼル
 - f. サイドカバー
4. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システム基板

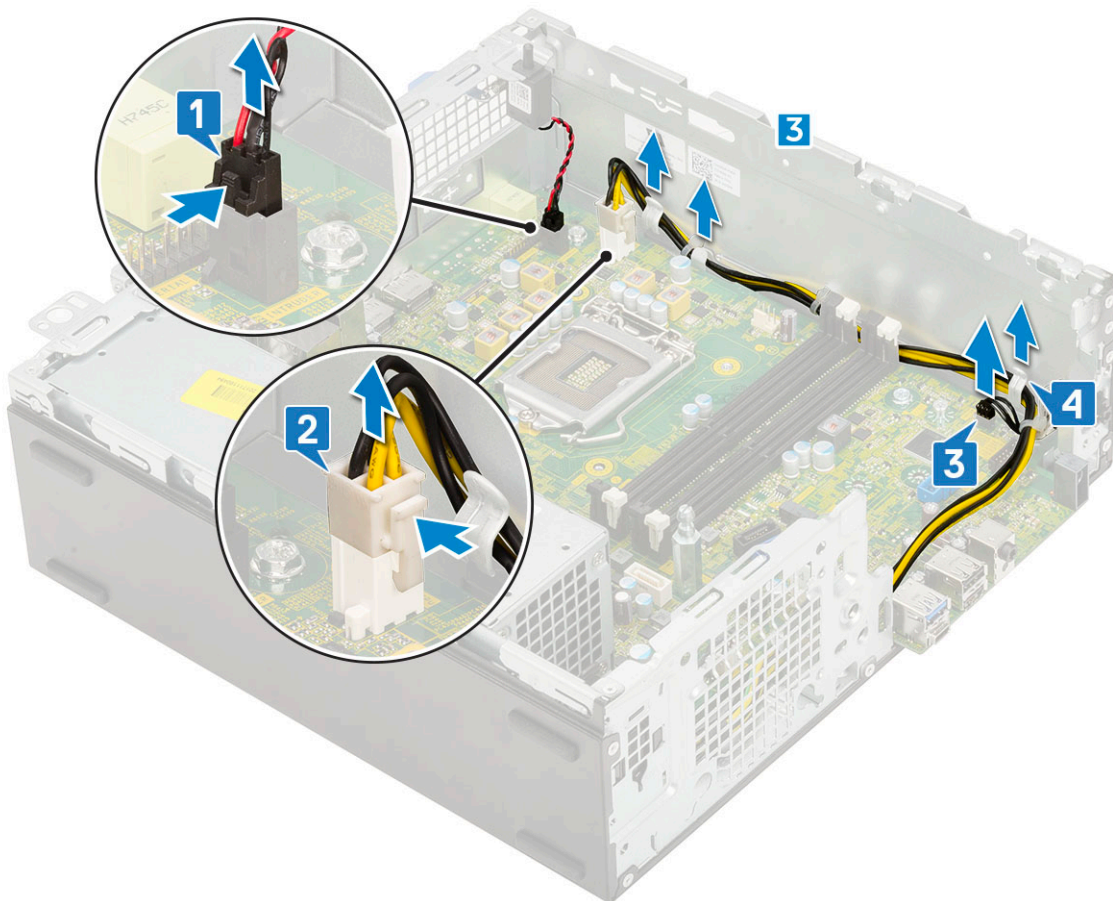
システム基板の取り外し

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a. サイドカバー
 - b. 前面ベゼル
 - c. HDDアセンブリ
 - d. ハードドライブと光ドライブモジュール
 - e. ヒートシンクアセンブリ
 - f. プロセッサ
 - g. メモリモジュール
 - h. M.2 PCIe SSD
3. I/Oパネルを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a. I/Oパネルを固定しているネジを外します [1]。

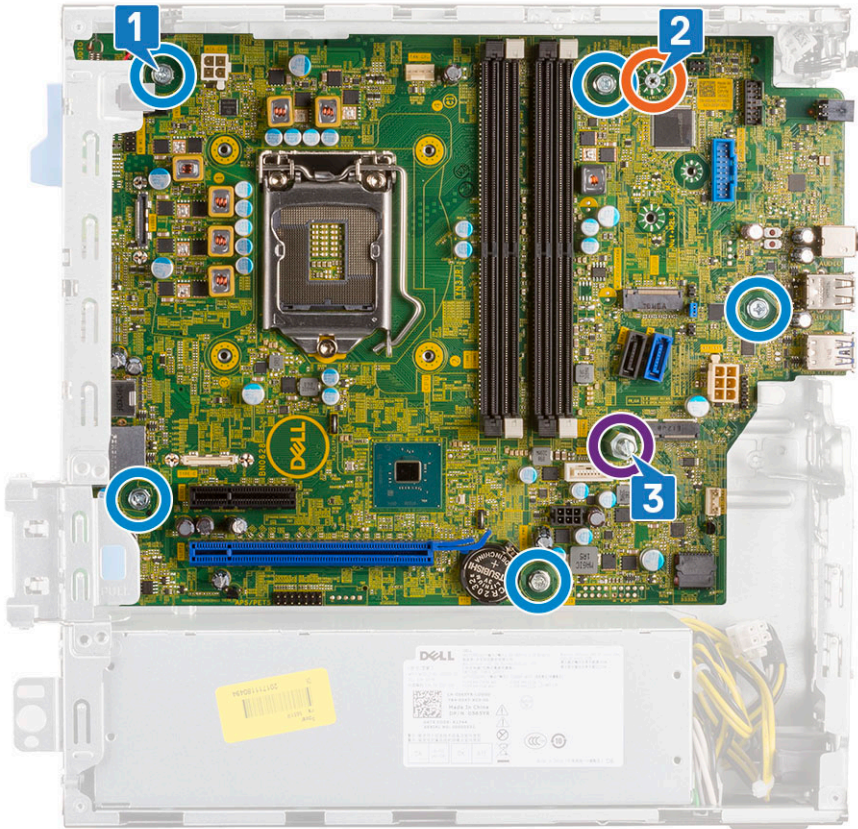
- b. I/O パネルを回転させて、システムから取り外します [2]。
- c. ハードドライブ データ ケーブル [3]、光ドライブ データ ケーブル [4]、電源ケーブル [5] をシステム基板のコネクタから外します。



- 4. システム基板のコネクタから次のケーブルを外します。
 - a. インテルージョンスイッチ [1]
 - b. CPU 電源 [2]
 - c. 電源スイッチ [3]
- 5. PSU ケーブルの配線を固定クリップから外します [4]。

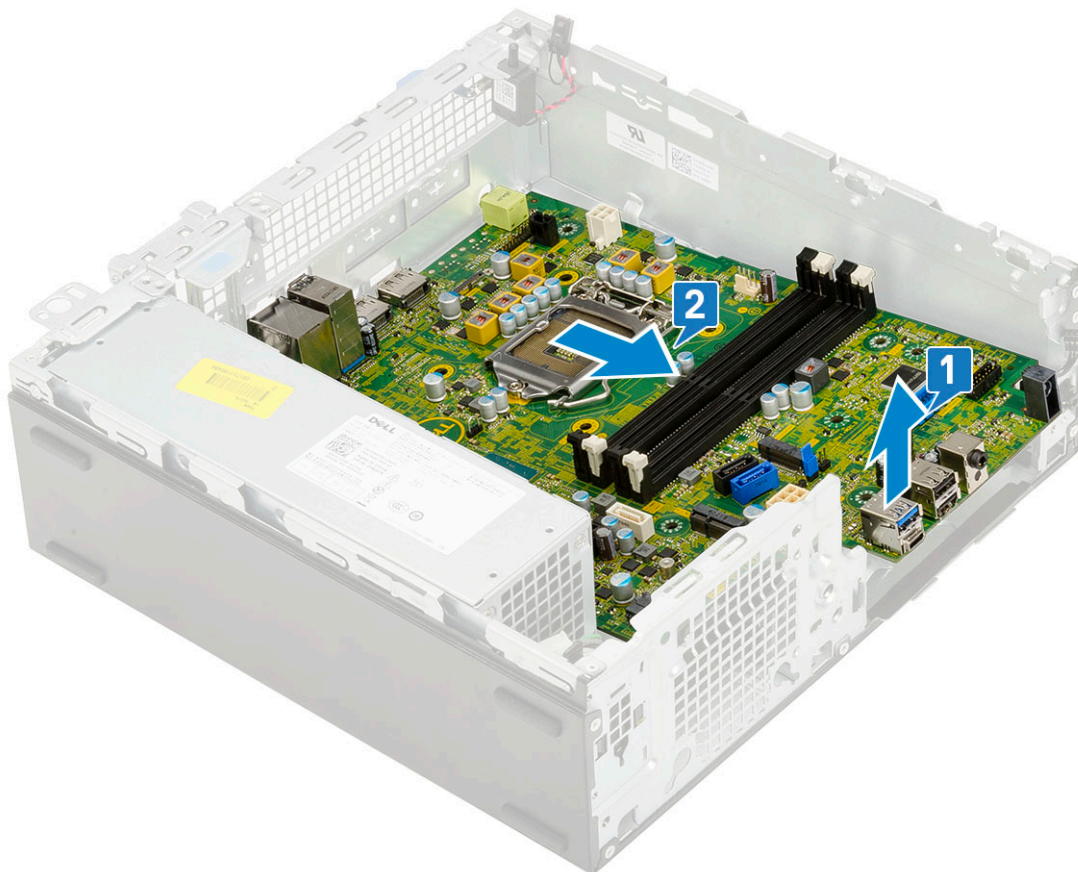


6. システム基板からネジを取り外すには、次の手順を実行します。
- a. システム基板をシャーシに固定している5本のネジを取り外します [1]。
 - b. M.2 SSD ドライブの取り付け位置として使用されている1本のネジ [2]と、システム基板をシステムに固定している1本の突起ネジ (#6-32) [3]を外します [3]。



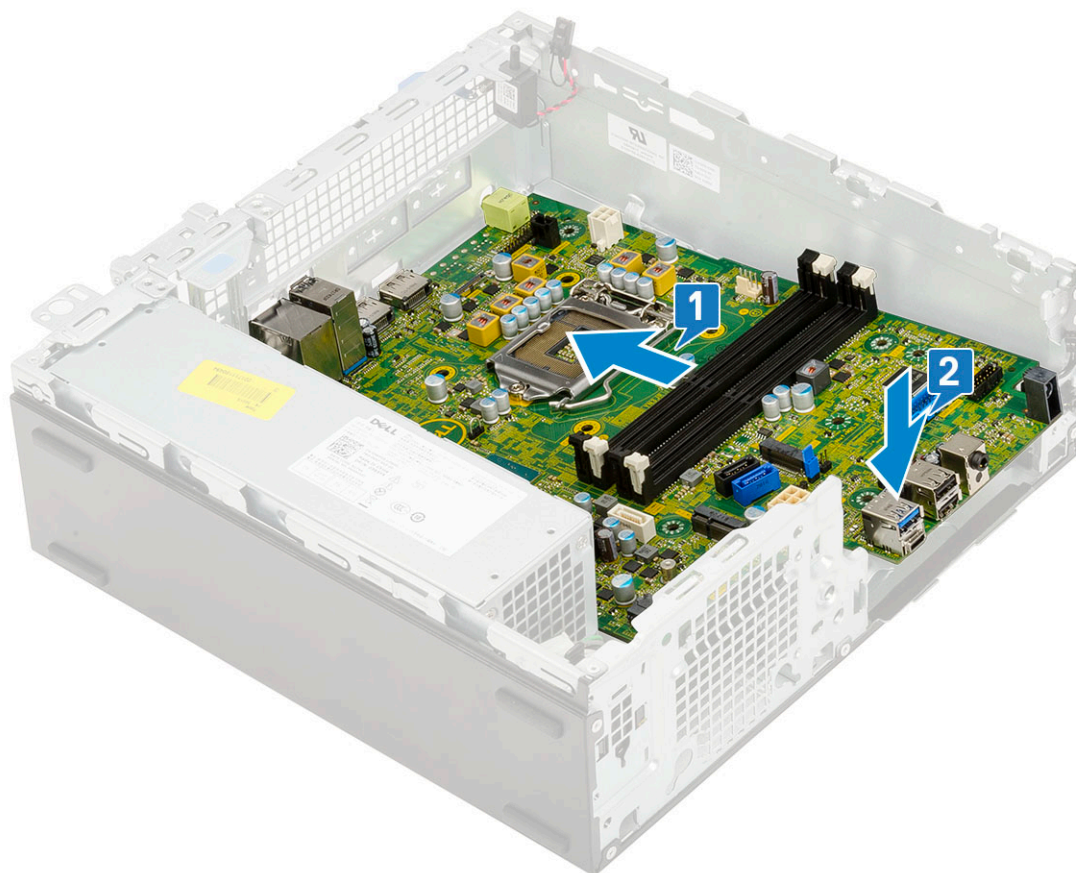
7. システム基板を取り外すには、次の手順を実行します。

- a. システム基板をスライドさせて持ち上げ、シャーシから取り外します [1、2]。

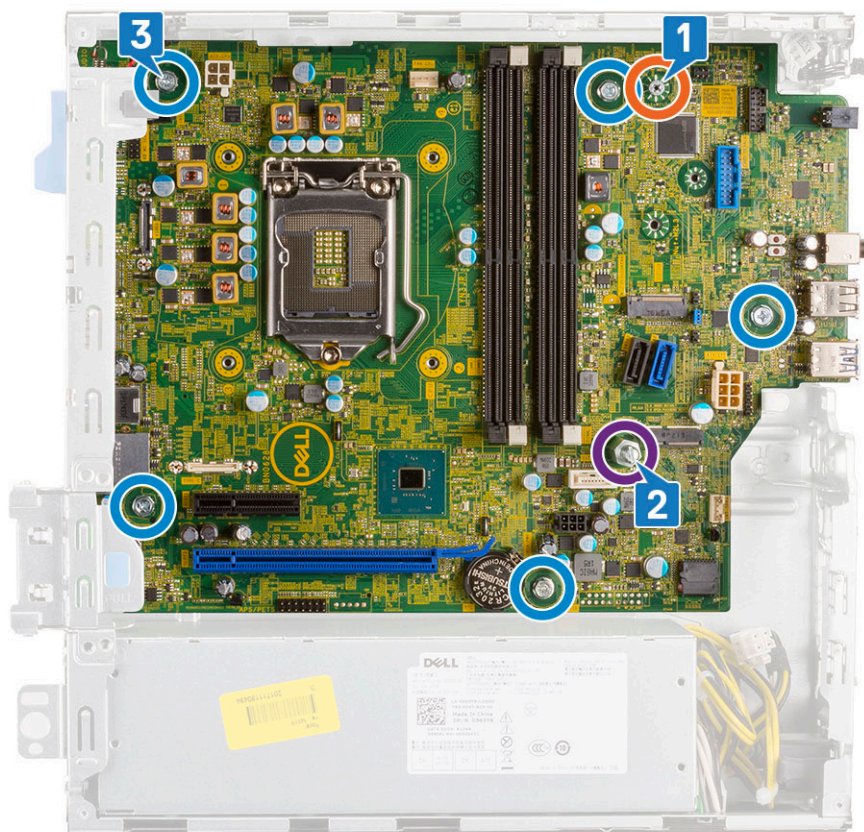


システム基板の取り付け

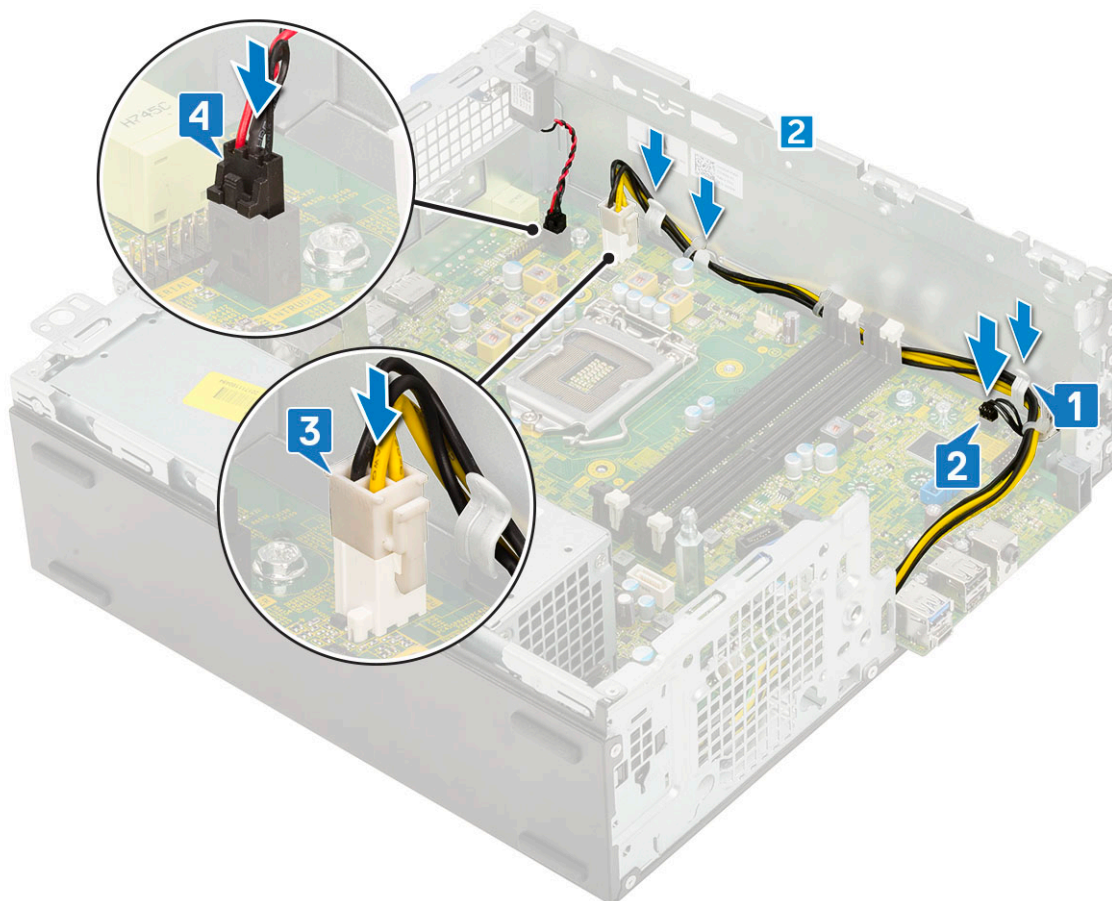
1. システム基板の両端をつかみ、システムの背面に対して位置を合わせます。
2. システム基板の背面にあるコネクタがシャーシのスロットと揃い、システム基板のネジ穴がシステムシャーシの突起と揃うまで、システム基板をシステムシャーシに下ろします [1、2]。



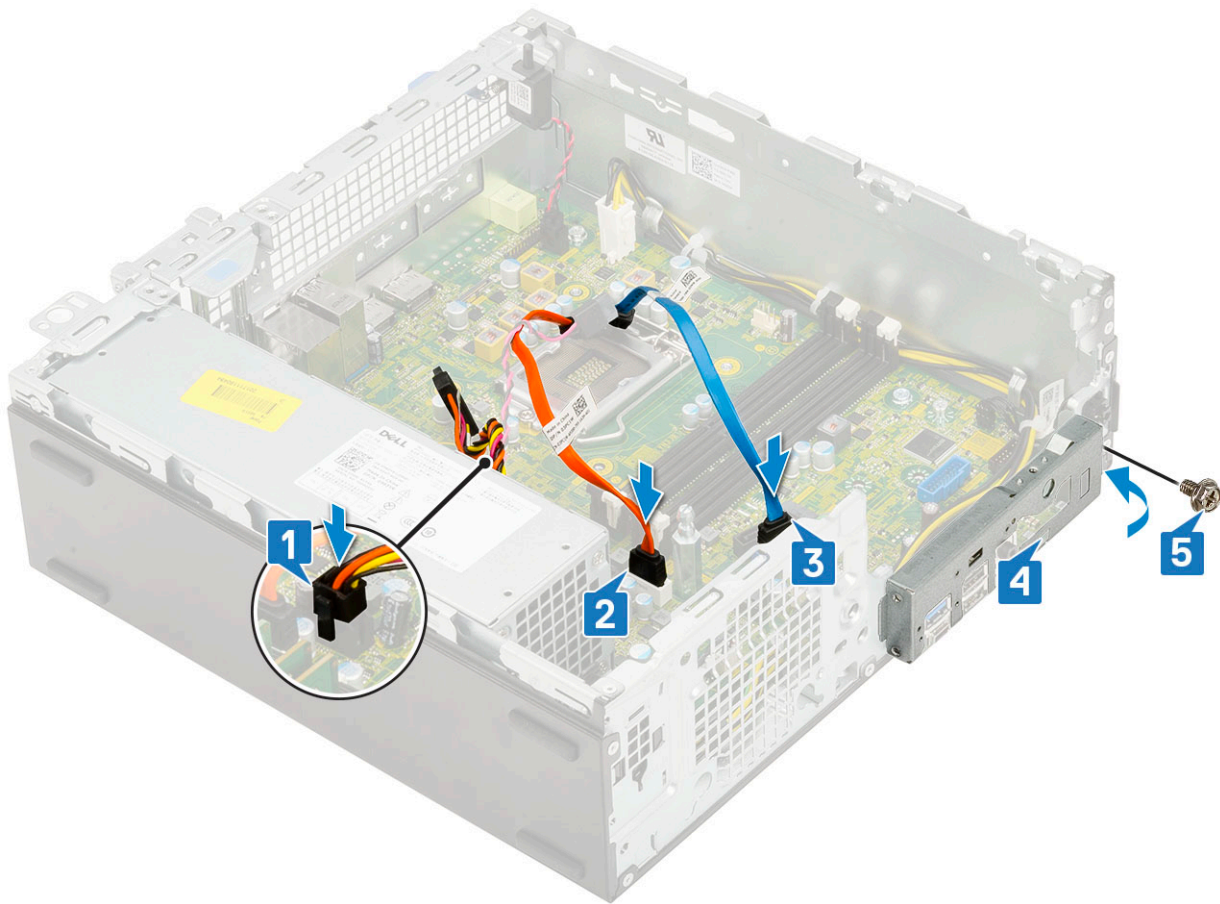
3. 1本の突起ネジ (#6-32)、M.2 SSD ドライブの取り付け位置として使用されている1本のネジ、システム基板をシステムに固定する5本のネジを取り付けます [1、2、3][1、2]。



4. すべてのケーブルを配線クリップを通して配線します [1]。
5. ケーブルとシステム基板上的コネクタのピンの位置を合わせて次のケーブルをシステム基板に接続します。
 - a. 電源スイッチ [2]
 - b. CPU 電源 [3]
 - c. インテルージョンスイッチ [4]



6. 電源ケーブル、オプティカルドライブデータケーブル、ハードドライブデータケーブルを接続します [1、2、3]。
7. I/O パネルのフックをシャーシのスロットに挿入し、回転させて I/O パネルを閉じます [4]。
8. ネジを取り付けて、I/O パネルをシャーシに固定します [5]。



9. 次のコンポーネントを取り付けます。
- a. M.2 PCIe SSD
 - b. メモリモジュール
 - c. プロセッサ
 - d. ヒートシンクアセンブリ
 - e. ハードドライブとオプティカルドライブ モジュール
 - f. ハードディスク ドライブ アセンブリ
 - g. 前面ベゼル
 - h. サイドカバー
10. 「コンピュータ内部の作業を終えた後に」 の手順に従います。

トラブルシューティング

トピック：

- 強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断
- 電源供給ユニットのビルトイン自己テスト
- 診断
- 診断エラーメッセージ
- システムエラーメッセージ
- オペレーティング システムのリカバリ
- リアルタイム クロック (RTC リセット)
- バックアップ メディアとリカバリー オプション
- Wi-Fi 電源の入れ直し

強化された起動前システムアセスメント - ePSA 診断

ePSA 診断 (システム診断としても知られている) ではハードウェアの完全なチェックを実施します。ePSA には BIOS が組み込まれており、BIOS によって内部的に起動されます。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスやデバイスグループ用の一連のオプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

△ 注意: システム診断プログラムは、お使いのコンピュータをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のコンピュータで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。

ⓘ メモ: 特定のデバイスのテストではユーザー操作が必要となる場合があります。診断テストを実行する際には、常にコンピュータ端末の前にいるようにしてください。

ePSA 診断の実行

次の方法のいずれかでブート診断を起動します。

1. コンピュータの電源を入れます。
2. コンピューターが起動しデルのロゴが表示されたら、F12 キーを押します。
3. ブートメニュー画面で、上/下矢印キーを使用して [[診断]] オプションを選択したら [Enter] を押します。
 - ⓘ メモ:** [[強化された起動前システム アセスメント]] ウィンドウが表示され、コンピューター内で検出されたすべてのデバイスが一覧で表示されます。診断プログラムが、検出されたすべてのデバイスのテストを開始します。
4. 右下隅にある矢印を押して、ページリストに移動します。検出されたアイテムが一覧で表示され、テストが実行されます。
5. 特定のデバイスで診断テストを実行するには、<Esc> を押して [はい] をクリックし、診断テストを中止します。
6. 左のパネルからデバイスを選択し、[テストの実行] をクリックします。
7. 何か問題がある場合は、エラーコードが表示されます。エラーコードをメモしてデルに連絡してください。

電源供給ユニットのビルトイン自己テスト

ビルトイン自己テスト (BIST) は、電源供給ユニットが動作しているかどうかを判断するのに役立ちます。デスクトップ PC またはオールインワン PC の電源供給ユニットで自己テスト診断を実行するには、www.dell.com/support でナレッジ ベース記事 000125179 を参照してください。

診断

コンピュータの POST (パワーオンセルフテスト) では、起動プロセスを開始する前に、コンピュータの基本要件が満たされハードウェアが適切に動作していることを確認します。コンピュータが POST に合格すると、通常モードでの起動を続行します。しかし、コンピュータが POST に合格しなかった場合は、起動中に LED が一連のコードを発します。システム LED は電源ボタンに組み込まれています。

次の表は、異なるライトパターンとその意味を示しています。

表 3. 点灯中の LED のサマリー

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
消灯	消灯	S5	
消灯	点滅	S3、PWRGD_PS なし	
以前の状態	以前の状態	S3、PWRGD_PS なし	この項目は、SLP_S3#アクティブから PWRGD_PS 非アクティブまでの遅延の可能性の有無を示します。
点滅	消灯	S0、PWRGD_PS なし	
青色に	消灯	S0、PWRGD_PS なし、コードのフェッチ=0	
消灯	青色に	S0、PWRGD_PS なし、コードのフェッチ=1	これは、ホスト BIOS の実行が開始され、LED レジスタが書き込み可能になったことを示します。

表 4. 橙色の LED の点滅障害

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
2	1	MBD が不良	MBD が不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 A、G、H、J - Post 前インジケータ [40]
2	2	MB、PSU、またはケーブルが不良	MBD、PSU、または PSU ケーブルが不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 B、C、D [40]
2	3	MBD、DIMM、または CPU が不良	MBD、DIMM、または CPU が不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 F および K [40]
2	4	コイン型電池の不良	コイン型電池の不良 - SIO 仕様の表 12.4 の行 M [40]

表 5. ホスト BIOS 制御下の状態

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
2	5	BIOS の状態 1	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0001) BIOS の破損。
2	6	BIOS の状態 2	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0010) CPU の設定または CPU の障害。

表 5. ホスト BIOS 制御下の状態 (続き)

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	システムの状態	メモ
2	7	BIOS の状態 3	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0011) メモリ設定処理中。検出されたメモリ モジュールは正常ですが、障害が発生しました。
3	1	BIOS の状態 4	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0100) PCI デバイスの設定または障害と、ビデオサブシステムの設定または障害の組み合わせ。BIOS が 0101 ビデオコードを除去します。
3	2	BIOS の状態 5	BIOS の Post コード (古い LED パターン 0110) ストレージおよび USB の設定または障害の組み合わせ。BIOS が 0111 USB コードを除去します。
3	3	BIOS の状態 6	BIOS の Post コード (古い LED パターン 1000) メモリ設定、メモリ非検出。
3	4	BIOS の状態 7	BIOS の Post コード (古い LED パターン 1001) マザーボードの致命的エラー。
3	5	BIOS の状態 8	BIOS の Post コード (古い LED パターン 1010) メモリの設定、互換性のないモジュールまたは無効なモジュール
3	6	BIOS の状態 9	BIOS の Post コード (古い LED パターン 1011) 他のビデオ初期化前動作とリソース設定コードの組み合わせ。BIOS が 1100 コードを除去します。
3	7	BIOS の状態 10	BIOS の Post コード (古い LED パターン 1110) 他の Post 前動作、ビデオ初期化後のルーチン。

診断エラーメッセージ

表 6. 診断エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明
AUXILIARY DEVICE FAILURE	タッチパッドまたは外付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セットアップユーティリティで [Pointing Device] (ポインティングデバイス) オプションの設定を有効にします。
BAD COMMAND OR FILE NAME	コマンドのスペルは正しいか、空白の位置は正しいか、パス名は正しいかを確認してください。
CACHE DISABLED DUE TO FAILURE	マイクロプロセッサに内蔵の 1 次キャッシュに問題が発生しました。 デルへのお問い合わせ
CD DRIVE CONTROLLER FAILURE	コンピュータからのコマンドにオプティカルドライブが応答しません。

表 6. 診断エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	説明
DATA ERROR	ハードドライブからデータを読むことができません。
DECREASING AVAILABLE MEMORY	メモリモジュールに問題があるか、またはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
DISK C: FAILED INITIALIZATION	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。[Dell Diagnostics](診断) プログラムの Hard Disk Drive テストを実行します。
DRIVE NOT READY	操作を続行する前に、ベイにはハードドライブが必要です。ハードディスクドライブベイにハードディスクドライブを取り付けます。
ERROR READING PCMCIA CARD	コンピュータが、ExpressCard を認識できません。カードを挿入しなおすか、別のカードを使用してください。
EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED	不揮発性メモリ (NVRAM) に記録されているメモリ容量が、実際に取り付けられているメモリモジュールの容量と一致しません。コンピュータを再起動します。再度エラーが表示される場合は、 デルにお問い合わせください 。
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE	指定のディスクにコピーするにはファイルサイズが大きすぎます。またはディスクがいっぱいで入りません。他のディスクにコピーするか容量の大きなディスクを使用します。
A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > -	これらの文字はファイル名には使用しないでください。
GATE A20 FAILURE	メモリモジュールがしっかりと接続されていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
GENERAL FAILURE	オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージに続いて具体的な情報が表示されます。例えば、Printer out of paper. Take the appropriate action.
HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR	コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。[Dell Diagnostics](診断) プログラムの [Hard Disk Drive] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0	ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[Dell Diagnostics](診断) プログラムの [Hard Disk Drive] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE FAILURE	ハードディスクドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[Dell Diagnostics](診断) プログラムの [Hard Disk Drive] テストを実行します。
HARD-DISK DRIVE READ FAILURE	ハードディスクドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、ハードディスクドライブを取り外して、コンピュータをオプティカルドライブから起動します。

表 6. 診断エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	説明
	次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。[Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [Hard Disk Drive] テストを実行します。
INSERT BOOTABLE MEDIA	オペレーティングシステムは、オプティカルドライブなどの起動できないメディアから起動しようとしています。起動可能なメディアをセットします。
INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM	システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後などにこのメッセージが表示されることがあります。セットアップユーティリティで対応するオプションを修正します。
KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。[Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [Keyboard Controller] テストを実行します。
KEYBOARD CONTROLLER FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。[Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [Keyboard Controller] テストを実行します。
KEYBOARD DATA LINE FAILURE	外付けキーボードを使用している場合は、ケーブル接続を確認します。[Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [Keyboard Controller] テストを実行します。
KEYBOARD STUCK KEY FAILURE	外付けキーボードまたはキーパッドの、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。[Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [Stuck Key] テストを実行します。
LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT	Dell MediaDirect では、そのファイルのデジタル権限管理 (DRM) 制限が検証できないので、そのファイルは再生できません。
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY ALLOCATION ERROR	実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージが依然として表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE	メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要があれば交換します。
NO BOOT DEVICE AVAILABLE	コンピュータがハードディスクドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分 (パーティション) されているか確認します。
NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE	オペレーティングシステムが破損している可能性があります。 デルにお問い合わせください。

表 6. 診断エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	説明
NO TIMER TICK INTERRUPT	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 [Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [System Set] テストを実行します。
NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN	開いているプログラムの数が多すぎます。すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。
OPERATING SYSTEM NOT FOUND	OS の再インストール。問題が解決しない場合は、 デルにお問い合わせください。
OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM	オプション ROM に障害が発生しました。 デルにお問い合わせください。
SECTOR NOT FOUND	オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードディスクドライブが不良セクターを持っているか、FAT が破壊されている可能性があります。Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードディスクドライブのファイル構造を調べます。手順については、[Windows Help and Support] (ヘルプとサポート) を参照してください ([Start (スタート)] > [Help and Support (ヘルプとサポート)]) をクリックします)。多くのセクターに障害がある場合、データをバックアップして (可能な場合)、ハードディスクドライブをフォーマットします。
SEEK ERROR	オペレーティングシステムがハードディスクドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。
SHUTDOWN FAILURE	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 [Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [System Set] テストを実行します。再度メッセージが表示される場合は、 デルにお問い合わせください。
TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER	システム設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試み、それからすぐにプログラムを終了します。再度メッセージが表示される場合は、 デルにお問い合わせください。
TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED	システム設定をサポートする予備バッテリーに、再充電が必要である可能性があります。コンピュータをコンセントに接続してバッテリーを充電します。問題が解決しない場合は、 デルにお問い合わせください。
TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM	セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。[Date and Time] (日付と時刻) オプションの設定を修正します。
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。 [Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [System Set] テストを実行します。
UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE	キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。[Dell Diagnostics] (診断) プログラムの [System Memory] テストおよび [Keyboard Controller] テストを実行するか、 デルにお問い合わせください。
X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY	ディスクをドライブに挿入し、操作をやり直してください。

システムエラーメッセージ

表 7. システムエラーメッセージ

システムメッセージ	説明
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告: このシステムの前の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)	同じエラーによって、コンピュータは3回連続して起動ルーチンを終了できませんでした。
CMOS checksum error (CMOS チェックサムエラー)	RTC がリセットされ、[BIOS セットアップ] のデフォルトがロードされています。
CPU fan failure (CPU ファン障害)	CPU ファンに障害が発生しました。
System fan failure (システムファン障害)	システムファンに障害が発生しました。
Hard-disk drive failure (ハードディスクドライブ障害)	POST 中にハードディスクドライブに障害が発生した可能性があります。
Keyboard failure (キーボード障害)	キーボードに障害が発生したか、またはケーブルがしっかりと接続されていません。ケーブルをつなぎ直しても問題が解決しない場合はキーボードを交換してください。
No boot device available (起動デバイスがありません)	ハードディスクドライブ上に起動可能なパーティションが存在しないか、ハードドライブケーブルがしっかりと接続されていないか、または起動可能なデバイスが存在しません。 <ul style="list-style-type: none"> ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続されていること、およびドライブが適切に取り付けられ、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。 セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいことを確認します。
No timer tick interrupt (タイマーティック割り込み信号がありません)	システム基板上のチップが誤動作しているか、またはマザーボードに障害が発生している可能性があります。
NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem(注意 - ハードドライブの自己監視システムに、パラメーターが通常の動作範囲を超えていることがレポートされています。デルではデータを定期的にバックアップすることをお勧めしています。パラメーターが範囲を超えていても、ハードドライブに潜在的な問題がある場合とそうでない場合があります。)	S.M.A.R.T エラー、ハードディスクドライブに障害の可能性があります。

オペレーティング システムのリカバリ

PC で何度か試行してもオペレーティング システムが起動されない場合、Dell SupportAssist の OS のリカバリーが自動的に起動します。

Dell SupportAssist OS Recovery はスタンドアロン ツールで、Windows オペレーティング システムがインストールされている Dell の PC すべてにプレインストールされています。PC でオペレーティング システムが起動される前に発生する問題を診断してトラブルシューティングするツールで構成されています。ハードウェアの問題の診断、PC の修復、ファイルのバックアップ、PC の出荷時状態への復元を行うことができます。

ソフトウェアやハードウェアの障害が原因でプライマリオペレーティングシステムを起動できない場合、Dell サポート用 Web サイトからダウンロードし、PC をトラブルシューティングして修正できます。

Dell SupportAssist OS Recovery の詳細については、www.dell.com/serviceabilitytools にある『Dell SupportAssist OS Recovery ユーザーズガイド』を参照してください。[SupportAssist]、[SupportAssist OS Recovery] の順にクリックします。

リアルタイムクロック (RTC リセット)

リアルタイムクロック (RTC) リセット機能を使用すると、ユーザーやサービス技術者は、Dell 製システムを No POST/No Power/No Boot 状態からリカバリーできます。これらのモデルでは、レガシージャンパーを有効にした RTC リセットは廃止されました。


システムの電源がオフになっていて AC 電源に接続されている状態で、RTC のリセットを開始します。電源ボタンを 20 秒間押し続けます。電源ボタンを放すと、システムの RTC リセットが実行されます。

バックアップメディアとリカバリーオプション

Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、回復ドライブを作成することが推奨されています。デルでは、Dell PC の Windows オペレーティングシステムをリカバリーするために、複数のオプションを用意しています。詳細に関しては「[デルの Windows バックアップメディアおよびリカバリーオプション](#)」を参照してください。

Wi-Fi 電源の入れ直し

お使いのコンピューターが Wi-Fi 接続の問題が原因でインターネットにアクセスできない場合は、Wi-Fi 電源の入れ直し手順を実施することができます。次に、Wi-Fi 電源の入れ直しの実施方法についての手順を示します。

 **メモ:** 一部の ISP (インターネット サービス プロバイダ) はモデム/ルータ コンポ デバイスを提供しています。

1. コンピューターの電源を切ります。
2. モデムの電源を切ります。
3. ワイヤレス ルータの電源を切ります。
4. 30 秒待ちます。
5. ワイヤレス ルータの電源を入れます。
6. モデムの電源を入れます。
7. コンピューターの電源を入れます。

トピック：

- [デルへのお問い合わせ](#)

デルへのお問い合わせ

① **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. **Dell.com/support** にアクセスします。
2. サポートカテゴリを選択します。
3. ページの下部にある [国/地域の選択] ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。